

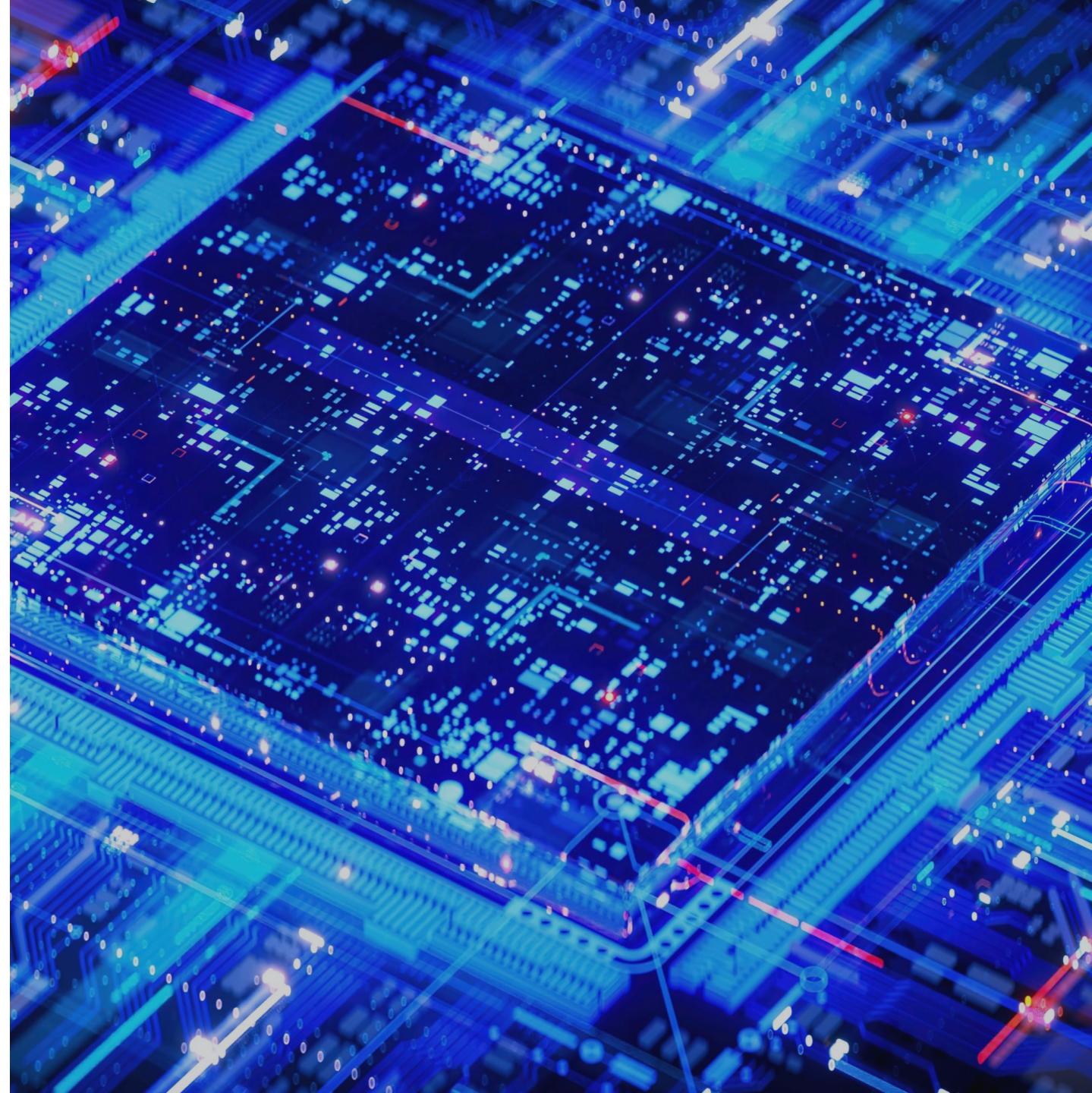
ULVAC

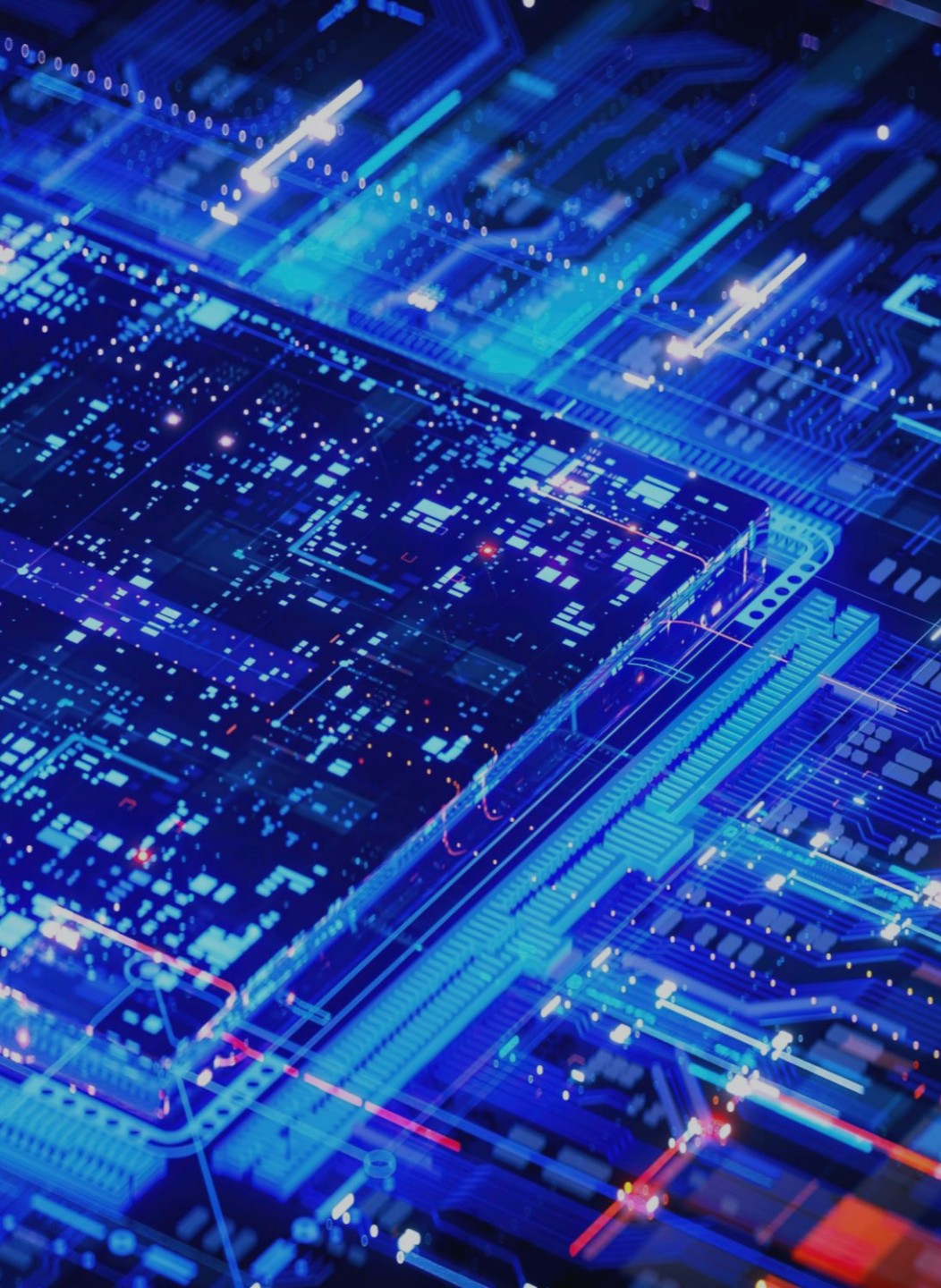
株式会社 アルバック

**2023年6月期
決算説明資料**

2022年7月～2023年6月

2023年8月8日





将来見通しに関する記述についての注意事項

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。

世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

2023年6月期連結業績

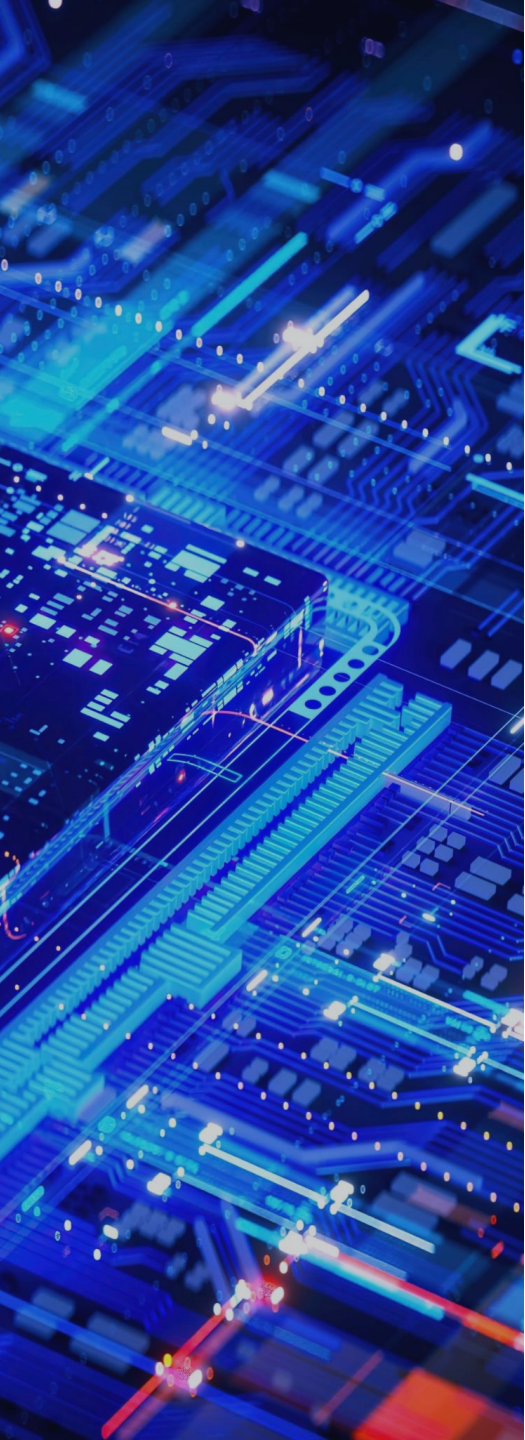
- 受注高・売上高ともに、ITパネル用LCD投資反動減等により前年同期比減少したが、半導体・電子・コンポーネント等は着実に増加
- 営業利益は、売上減少、先行投資となる半導体関連等の研究開発費増加等により前年同期比減少
- 売上高・営業利益とも前回修正予想を上回る

前中期経営計画の振り返り

- 当初の中期経営計画の売上目標2,100億円を上回る着地
- 半導体ロジック・パワーデバイス・各種電子デバイス等の成長ドライバーが牽引し、受注高は20/6期の1.6倍の2,472億円に成長
- モノづくり力強化による利益率改善は22/6上期まで着実に改善。その後、部品長納期化の影響等により効果低減、売上総利益率の改善目標は未達

新中期経営計画

- 基本方針：「真空技術による社会的価値創造」「利益・資本効率重視の経営」
- 26/6期目標：売上高3,000億円、売上総利益率35%、営業利益（率）480億円（16%）
- 24/6下期より売上高・営業利益ともに回復



2023年6月期 連結業績

- 受注高・売上高とも、半導体・電子・コンポーネント等が増加するも、FPD・材料の減少により、前年同期を下回った
- 営業利益率は、売上減少、先行研究開発費等販管費の増加等により8.8%（前年同期比▲3.7pt）に低下

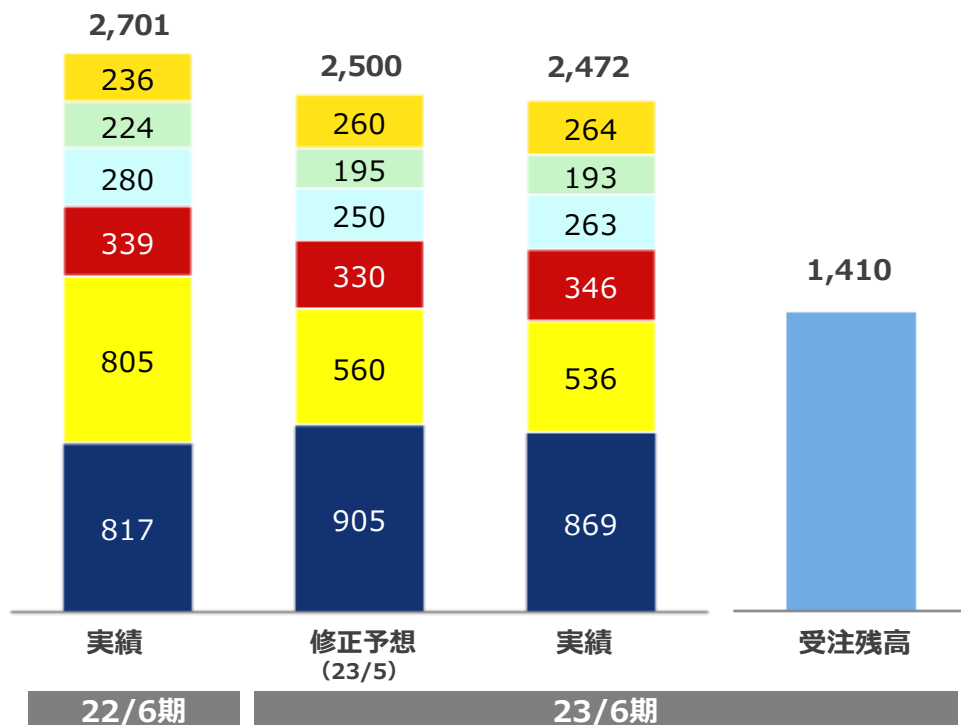
【単位：億円】	22/6期		23/6期				
	実績	修正予想	実績	前年同期比		予想比	
受注高	2,701	2,500	2,472	-229	-8%	-28	-1%
売上高	2,413	2,150	2,275	-138	-6%	+125	+6%
売上総利益	737	-	672	-65	-9%	-	-
率	30.6%	-	29.5%	-1.1pt	-	-	-
販管費	437	-	472	+35	+8%	-	-
営業利益	301	175	199	-102	-34%	+24	+14%
率	12.5%	8.1%	8.8%	-3.7pt	-	+0.6pt	-
経常利益	322	210	229	-93	-29%	+19	+9%
率	13.3%	9.8%	10.1%	-3.2pt	-	+0.3pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	202	160	142	-60	-30%	-18	-11%
率	8.4%	7.4%	6.2%	-2.2pt	-	-1.2pt	-

※23/5修正予想

- 受注高：半導体・電子やコンポーネント等が増加するも、FPDのITパネル用LCD投資反動減やFPD用材料の減少等により、前年同期を下回ったが、受注残高は1,410億円
- 売上高：半導体・電子やコンポーネント等が増加するも、FPD・材料の減少により、前年同期比減少したが、修正予想を上回る

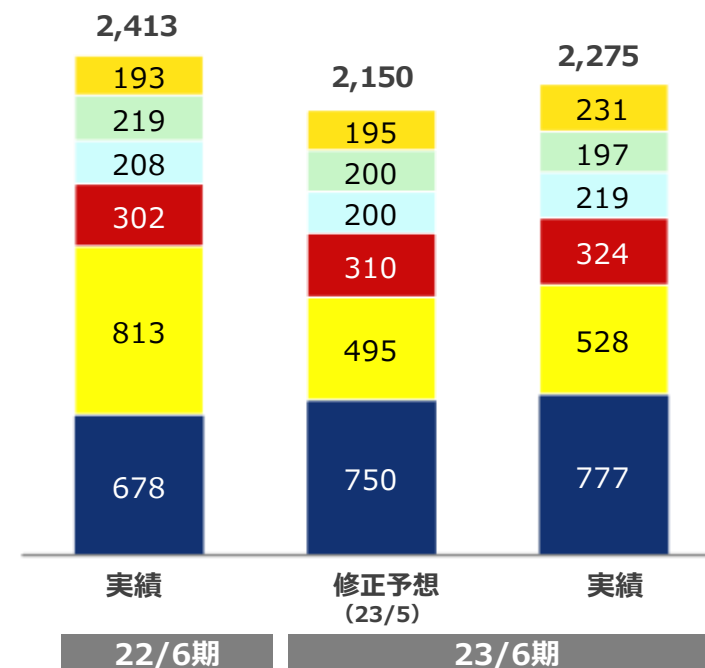
受注高

【単位：億円】



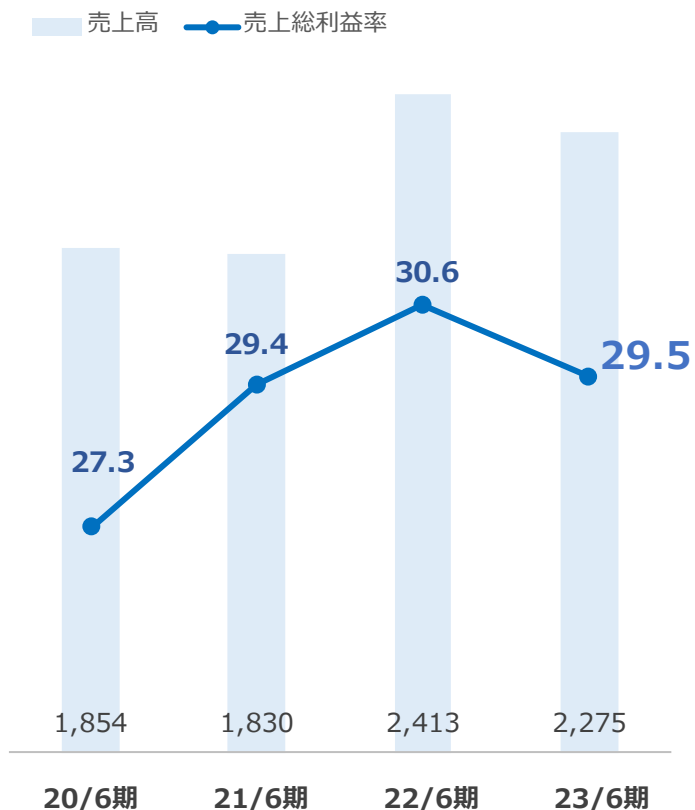
売上高

【単位：億円】

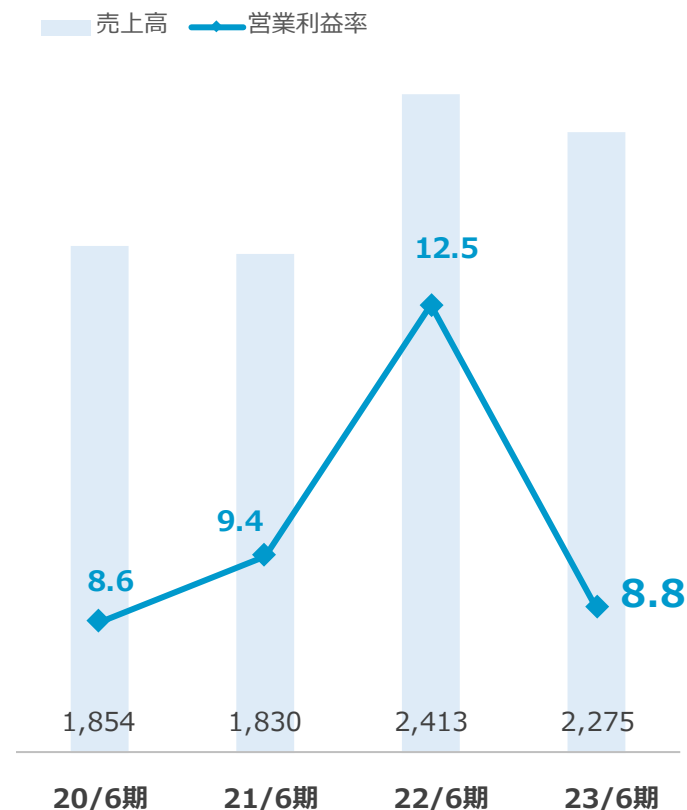


- 売上高減少に伴い、前年同期比、売上総利益率低下
- 売上総利益率の低下に加え、販管費（研究開発費）が増加し、前年同期比、営業利益率低下
- 先行投資となる半導体関連等の研究開発費が増加し販管费率上昇

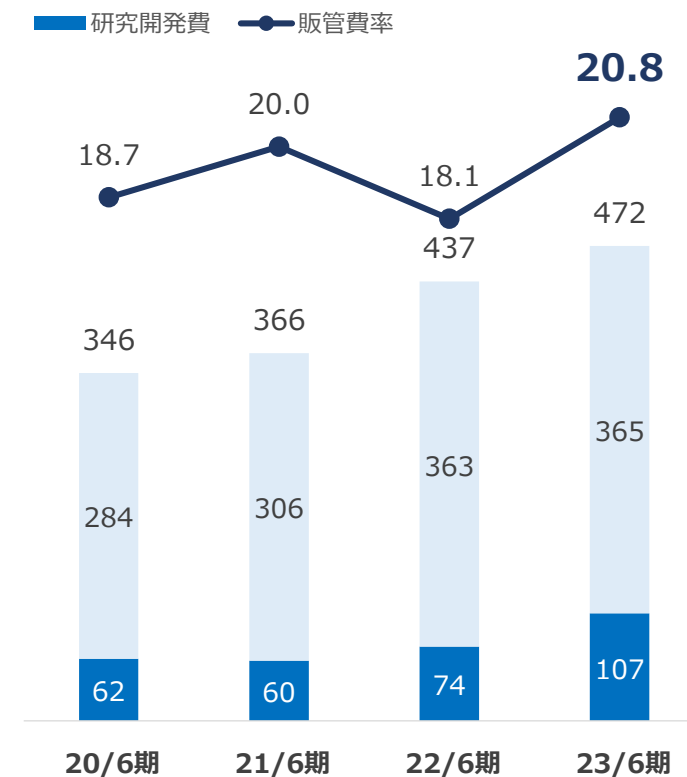
売上総利益率 【単位：億円、%】



営業利益率 【単位：億円、%】



販管費(率)推移 【単位：億円、%】

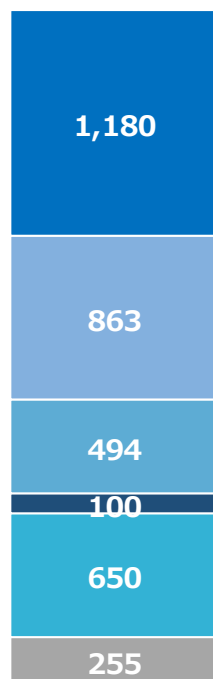


資産

【単位：億円】

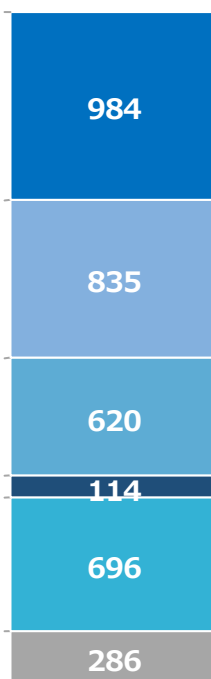
- 現金・預金
- 受取手形・売掛金
- 棚卸資産
- その他の流動資産
- 有形固定資産
- 投資有価証券 他

3,543



22/6期

3,535



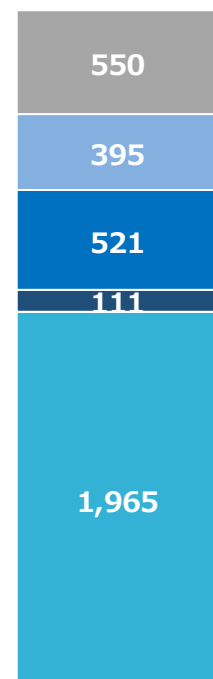
23/6期

負債・純資産

【単位：億円】

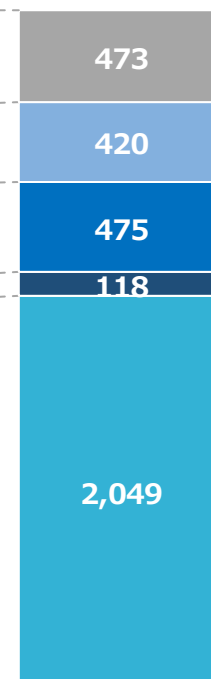
- 支払手形・買掛金
- 有利子負債
- その他流動負債
- その他固定負債
- 純資産

3,543



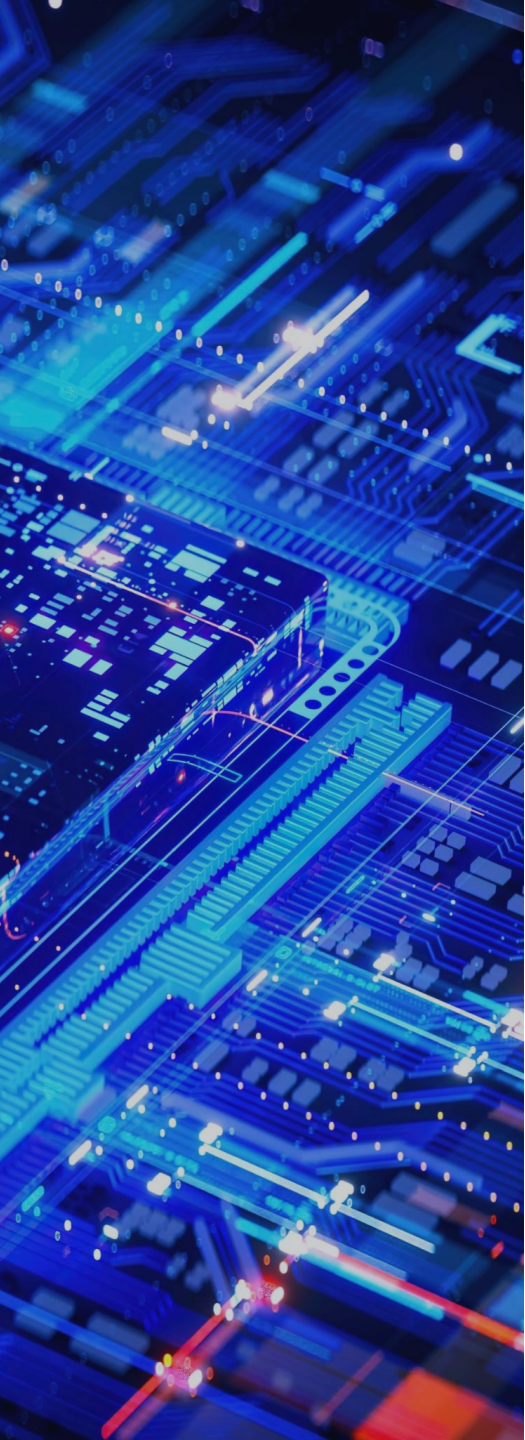
22/6期

3,535



23/6期

※前受金（契約負債）
227億円



前中期経営計画の振り返り

1 売上高実績

- 売上高：23/6期を含め毎年度、当初の中期経営計画値を上回った
半導体電子は計画を大きく上回る成長（特に受注の伸びが顕著）
- 受注高：毎年度、売上高を上回る実績で、23/6期末受注残高は1,410億円

売上高

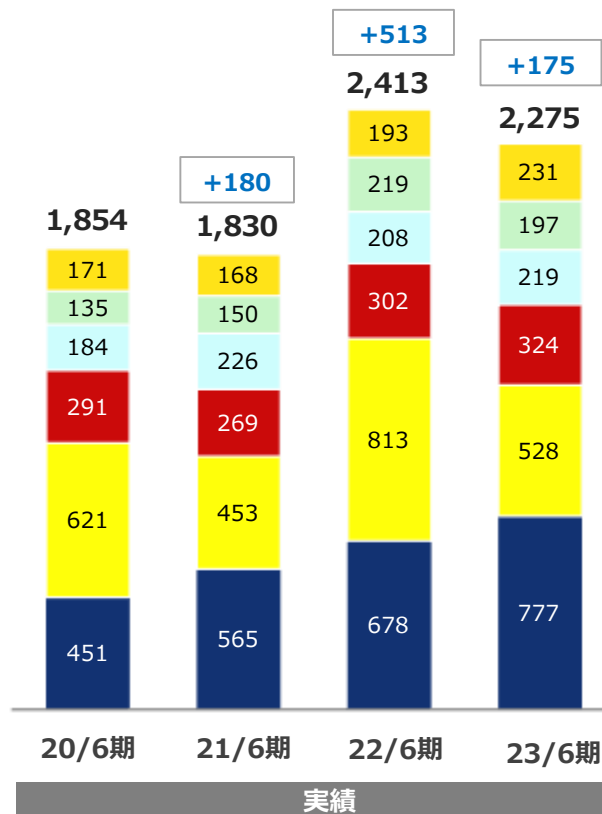
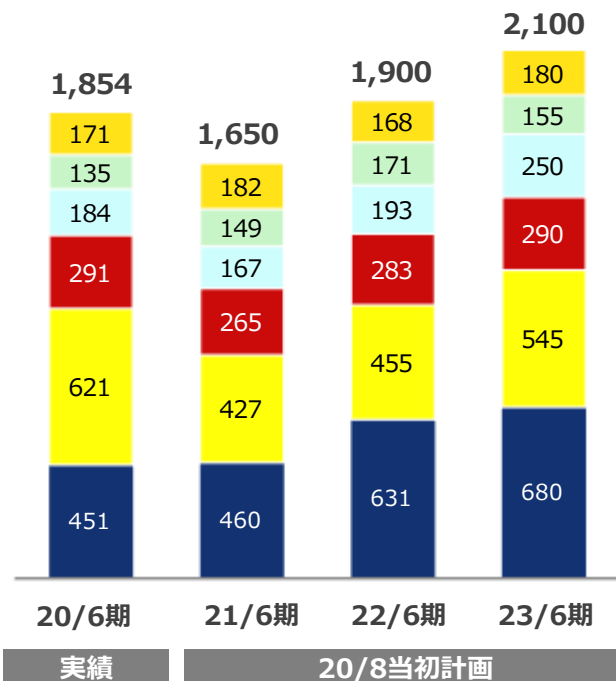
【単位：億円】



当初計画

実績

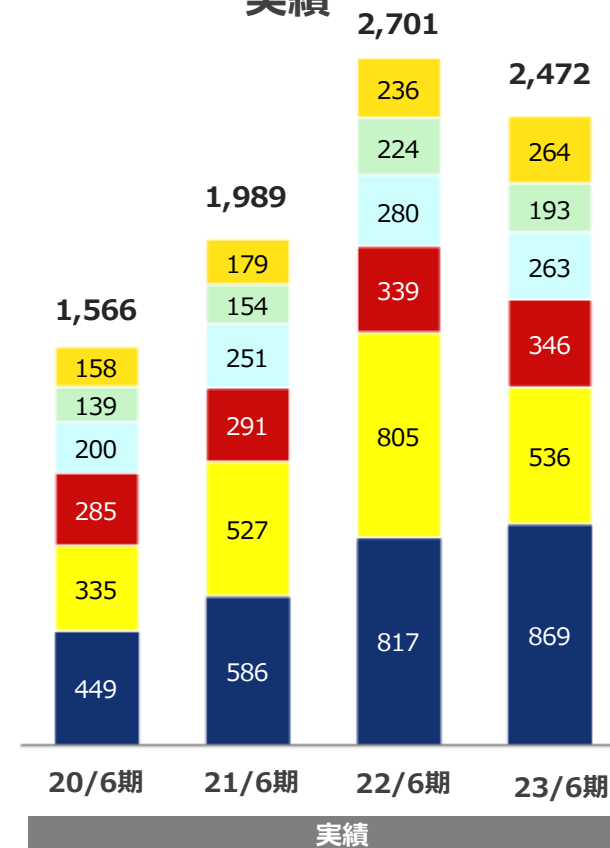
当初計画比



受注高

【単位：億円】

実績

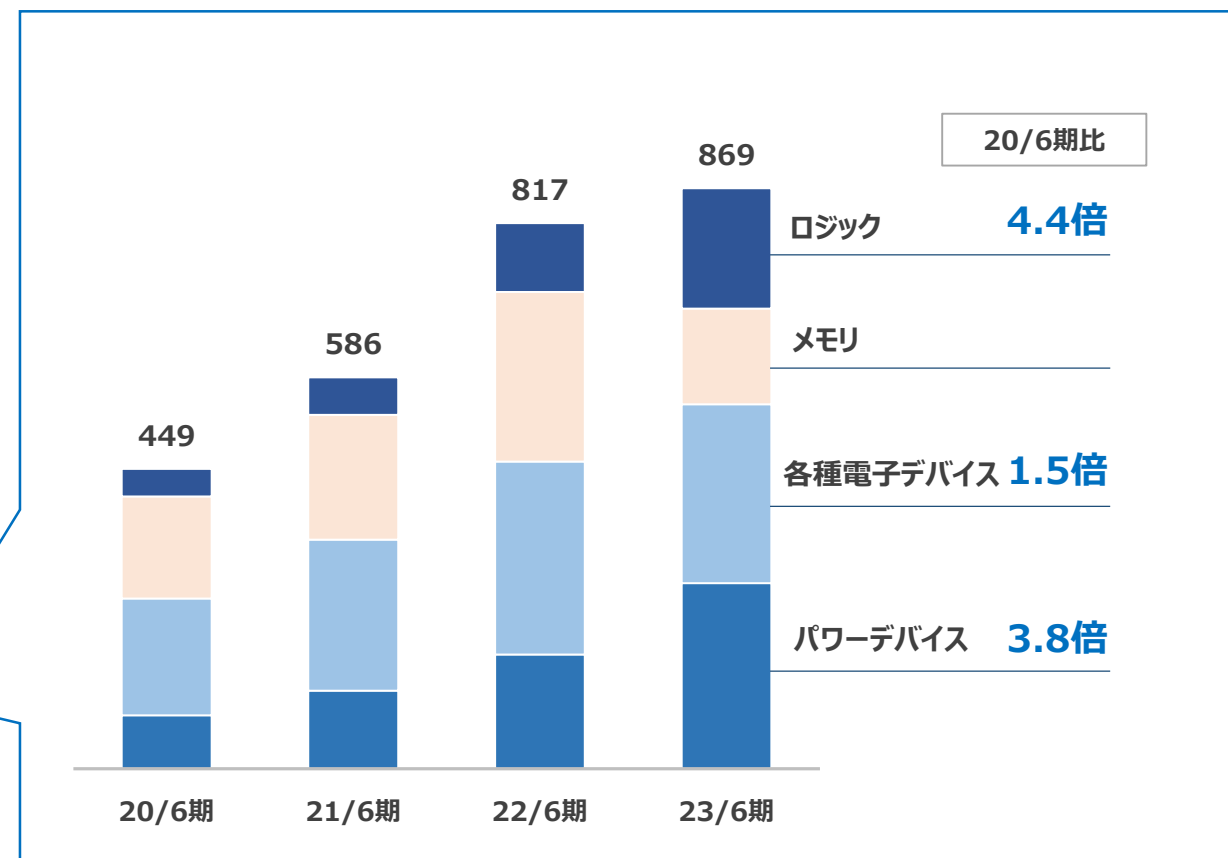
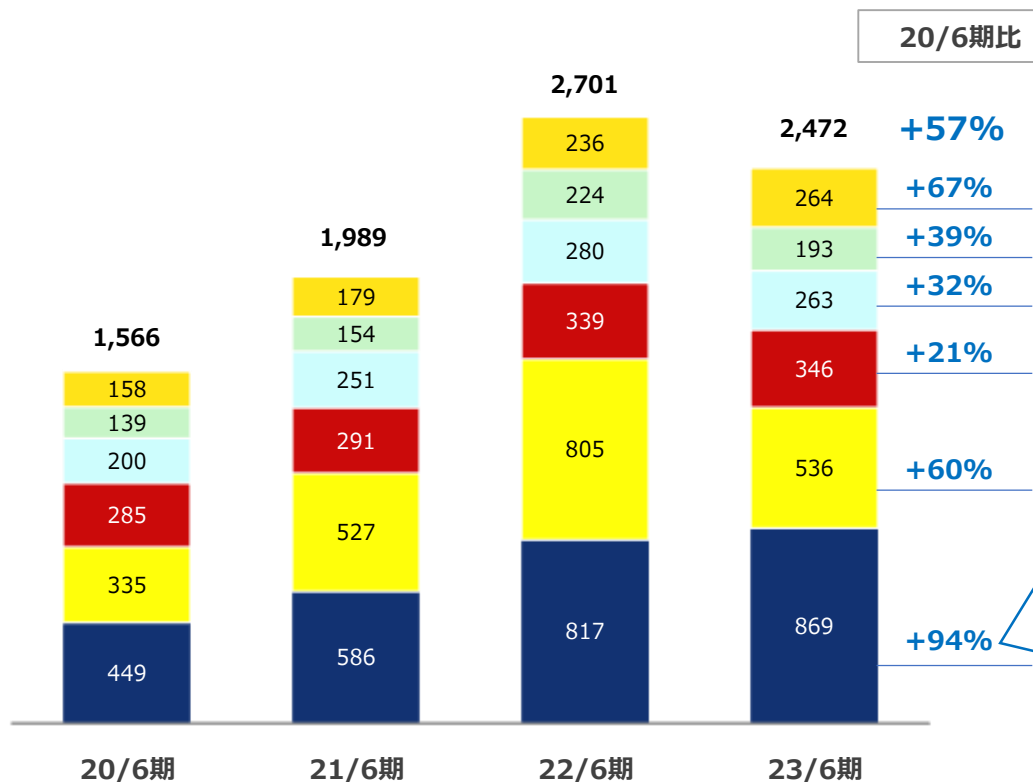


- FPDのITパネル用LCD投資反動減やFPD用材料の減少等により、前年同期比減少したが、半導体・電子はパワーデバイス・各種電子デバイス・ロジック等が牽引、コンポーネント、その他も着実に増加
- 23/6期の受注高は2,472億円と20/6期の1.6倍に成長

受注高

【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置	■ コンポーネント	■ 材料
■ FPD製造装置	■ 一般産業用装置	■ その他



基本方針

成長に向けた開発投資（選択と集中）

体質転換による利益重視の経営

重点戦略

成長事業の強化
研究開発力の強化

モノづくり力強化

グループ経営効率強化

経営基盤強化

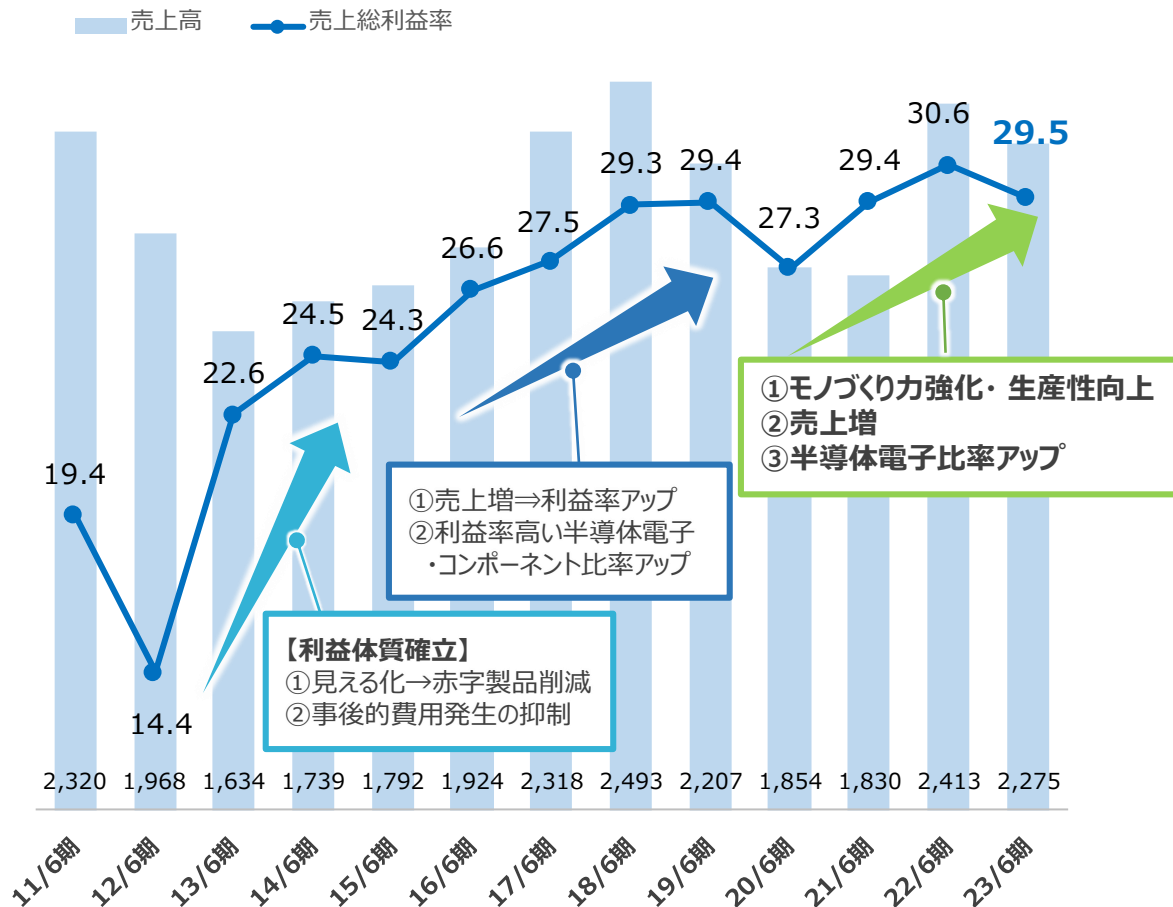
成果・進捗評価

- > 半導体：MHM工程に加え、新規顧客・新工程参入で成長
- > 電子：パワー・オプトデバイス等が日本・中国で大きく成長
- > FPD：EV用バッテリー装置の量産化スタート
- > 22/6上期までは着実に利益率改善するも、部品長納期化により効果低減、利益率目標は未達
- > 国内製造子会社統合、海外子会社統合等
- > 新人事制度導入
- > 生産性向上に向けた各種システムを整備
- > 財務基盤拡充

	売上高	当初目標	実績	評価	内容・要因等
成長事業の強化	20/6期実績			20/6期比	
・ 半導体	196億	320億	331億	◎ +69%	・ ロジックMHM・レガシー新規取引で成長
・ 電子	256億	410億	446億	◎ +74%	・ パワーデバイス投資等好調
・ FPD	621億	480億	528億	○ △15%	・ LCD投資継続・バッテリー投資開始
安定基盤ビジネス					
・ コンポーネント	291億	310億	324億	◎ +11%	・ EV/Liバッテリー用投資等好調
・ マテリアル	135億	160億	197億	◎ +46%	・ 半導体電子関連で成長
・ カスタマーサポート	売上高に対するCS割合 28%	30%	28%	△	・ FPD関連装置の一時的稼働率低下
グループ会社経営強化	20/6期比 売上高				
・ アルバック・クライオ		1.3倍	1.0倍	△	・ スマートフォン用OLED投資減少
・ アルバック成膜		1.7倍	1.1倍	△	・ 半導体分野への拡販の遅れ
・ アルバック・ファイ		1.2倍	1.6倍	◎	・ 新製品好評・中国市場伸長

- 22/6上期までは着実に利益率が改善したが、部品長納期化等により効果低減、利益率目標は未達だったが、中期経営計画期間平均（3年）では①17/6期までの26.1%から、②20/6期までの28.7%、③23/6期までの29.8%と着実に改善
- 半導体・パワーデバイス等を中心に計画的生産体制に順次シフト

売上総利益率推移 [単位：%]



利益率改善取組み

技術設計の改革

技術図面の完成度向上
設計バリューエンジニアリング強化



購買の改革

購買体制一体化
グローバル・サプライチェーン

生産工程の改革

生産拠点の専門化
製造生産性向上

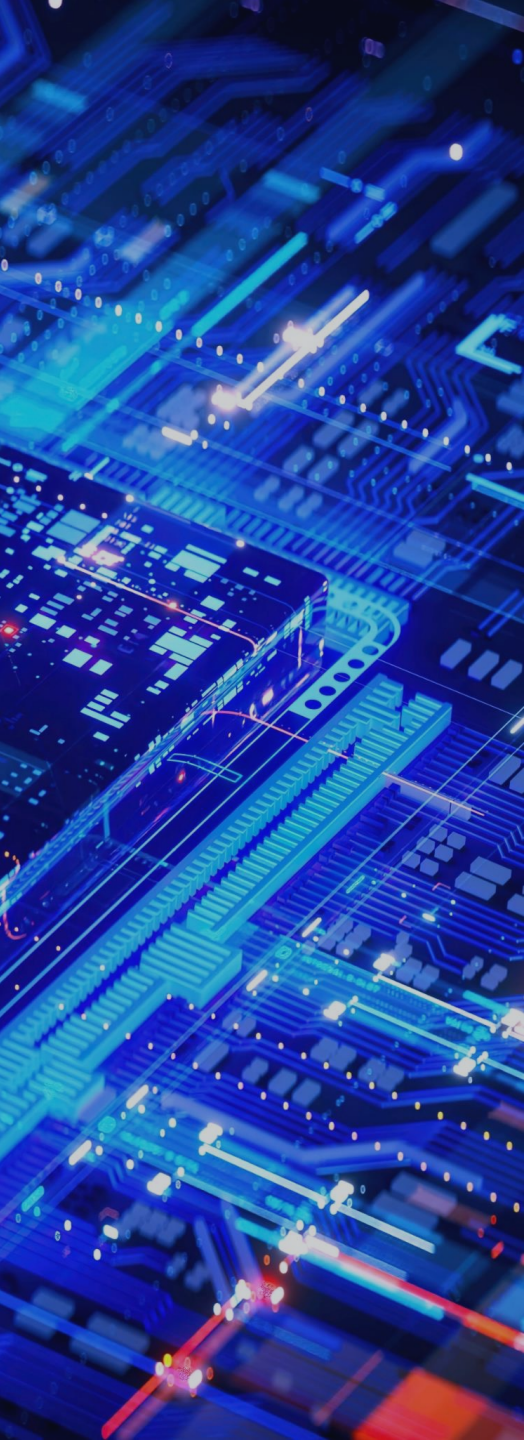
情報システム基盤強化

業務プロセス標準化
生産性向上・経営管理の高度化

部品長納期化の影響

- ① 工程組替え・二重作業負担・リードタイム長期化等による生産性低下
- ② 納期交渉優先によりモジュール化・部品共通化等によるボリュームディスカウント不調
- ③ 部品価格高騰の価格転嫁までのタイムラグ
⇒ モノづくり力強化による利益率改善効果低減

※売上貢献へのタイムラグ（売上低下）も発生



新中期経営計画

経営基本理念

アルバックグループは、互いに協力・連携し、真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、産業と科学の発展に貢献することを目指す

2050年ありたい姿

真空技術で世の中のためになる価値をパートナーとともに生み出し、人と地球の未来に貢献し続けている企業

- ＜経済成長・社会的豊かさ＞ 最先端の技術開発でより安全・安心、かつ豊かで便利な社会の実現に貢献する
- ＜人の幸せ＞ すべての人が幸せな生活を送るための社会づくりに貢献する
- ＜環境＞ 地球にやさしく持続可能な社会づくりに貢献する

Vision 2032

未来につながる「可能性の場」であり続ける

マテリアリティ

- 真空技術をコアとしたイノベーションの創出・共創の推進
- 多様な人財の育成と活躍推進・レジリエントな組織づくり
- バリューチェーンにおける人権尊重・責任ある行動
- 持続可能な地球環境への貢献

前中期経営計画

- 開発投資⇒半導体電子の成長により、売上高は当初計画を上回る
- 前期期初、上方修正した売上計画2,500億円（その後下方修正）に対し、受注は2,472億円（20/6期の1.6倍）とほぼ達成⇒市場を捉えたビジネス展開実現
- 一方、部品長納期化の影響で、①受注に対し売上進捗が低水準、②モノづくり力強化による利益率改善成果低減⇒利益率目標未達、2つの課題が残った

新中期経営計画

- 中長期的に成長する半導体・電子+バッテリー市場 = 成長機会
- 成長戦略・市場競争力は着実に向上
- モノづくり力強化による生産性向上により、利益率改善・3,000億円生産体制構築を推進（計画的生産移行を順次推進中）

< 基本方針 >

真空技術による社会的価値創造

利益・資本効率重視の経営

重点戦略

ポイント

① 成長事業における
製品競争力の強化

- > 共創によるイノベーションの推進
- > 半導体・電子装置事業の拡大
- > カスタマーサービス事業の強化

② グローバル生産性の向上

- > モノづくり力強化
- > デジタル化の推進

③ 経営基盤の強化

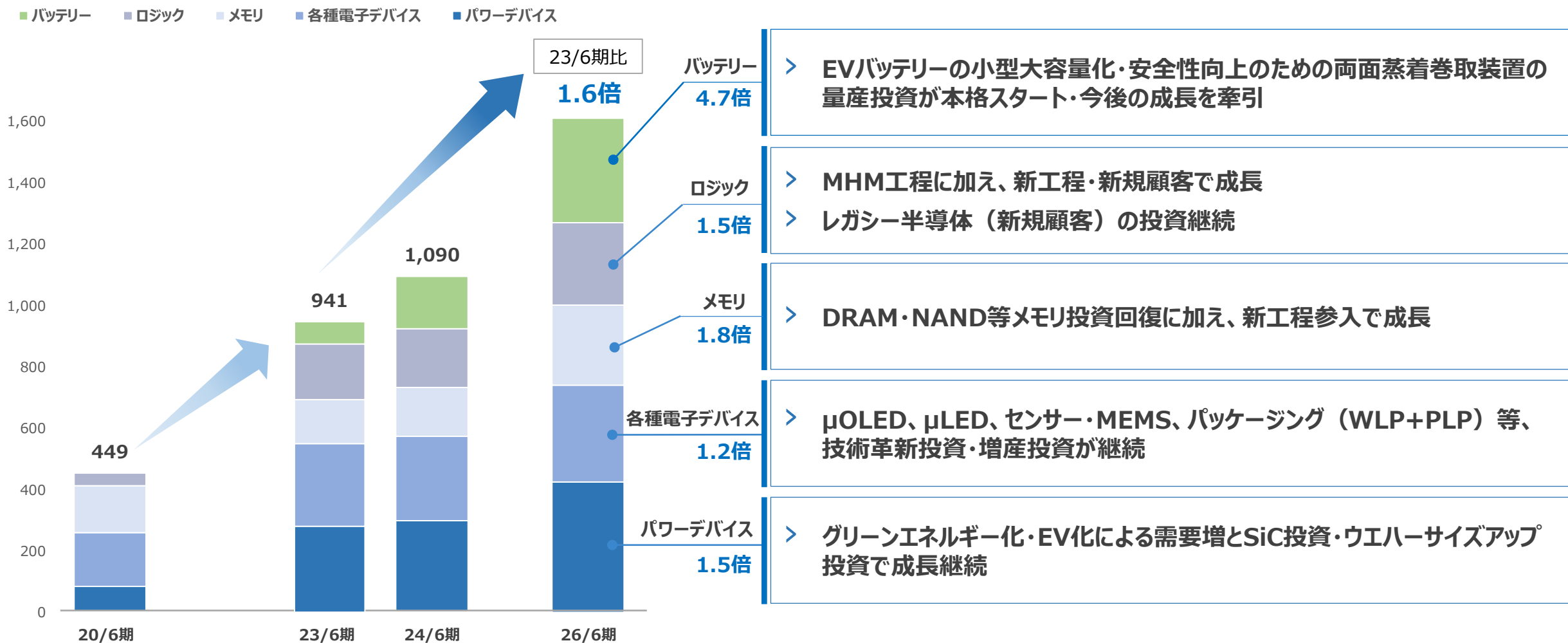
- > ESG経営の強化
- > 財務基盤の強化・CFマネジメントの強化
- > 人財経営の推進

- 「スマート社会化・デジタル化・メタバース」×「AI」×「グリーンエネルギー化」
半導体・各種電子デバイス・バッテリー：「技術革新」×「増産」
- 地域サプライチェーン構築（政府支援）



地域サプライチェーン構築 政府支援による工場誘致

成長ドライバーの受注計画 【単位：億円】



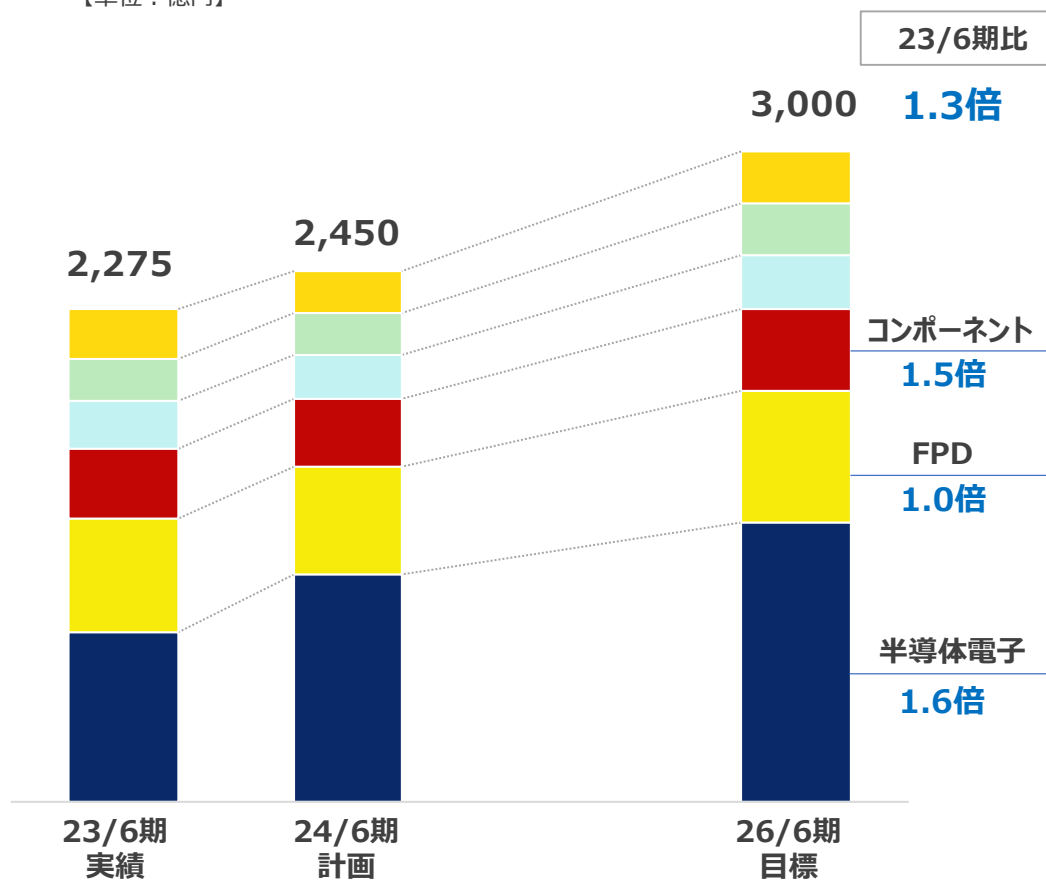
	23/6期	26/6期	
	実績	目標	
売上高	2,275億円	3,000億円	23/6期比 +725億円 (+32%)
売上総利益率	29.5%	35%	+5.5pt
営業利益(率)	199億円(8.8%)	480億円(16%)	+281億円 (+7.2pt)
ROE	7.3%	14%	+6.7pt
営業CF (3年間累計)	605億円	630億円	+25億円 (+4%)

- 24/6下期より売上高・営業利益ともに回復
- 25/6期も更に売上高・営業利益が改善し、26/6期は売上高3,000億円・営業利益480億円を目指す

売上高



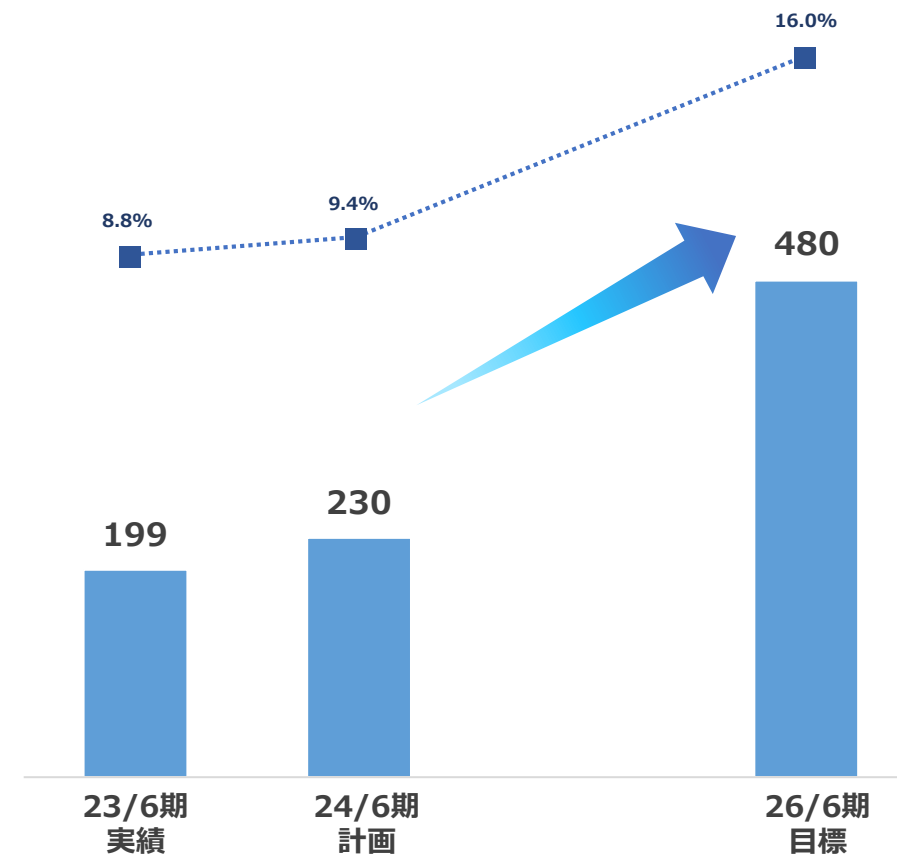
【単位：億円】



営業利益（率）

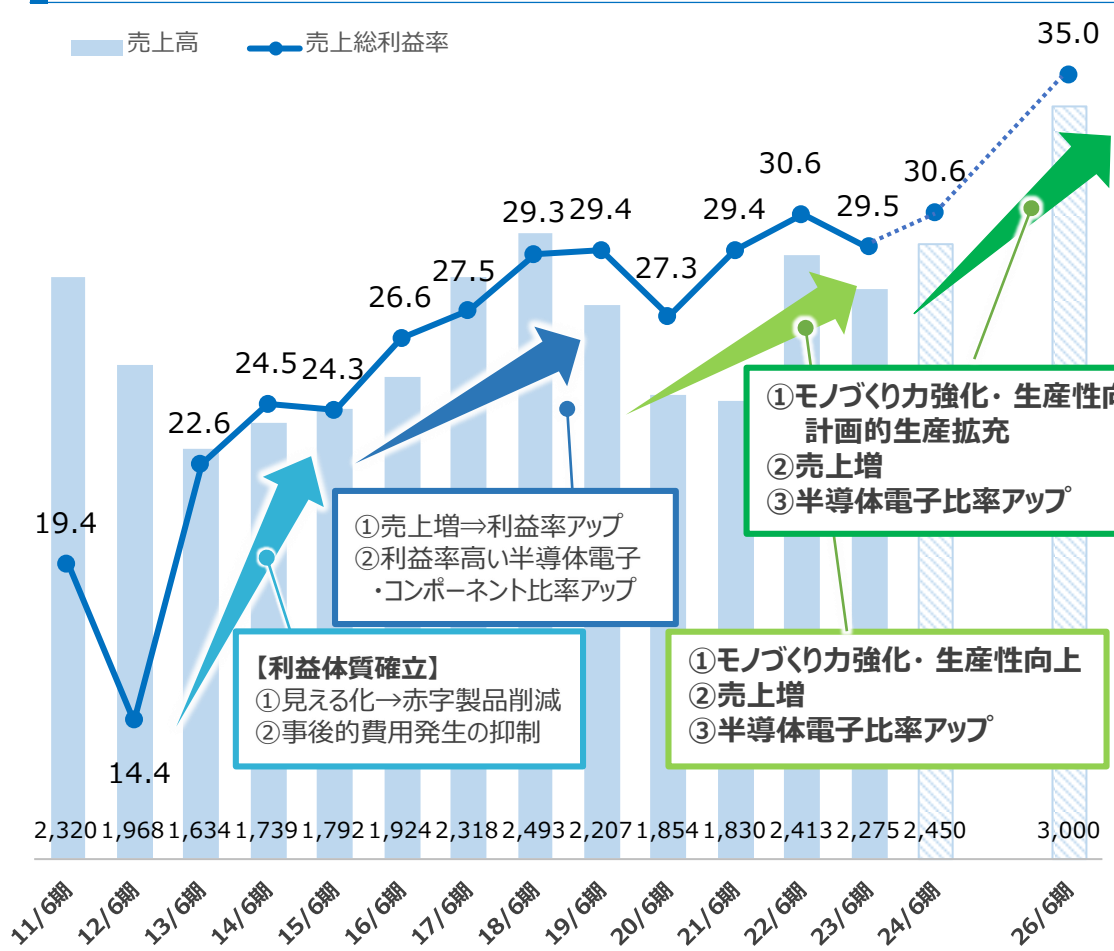


【単位：億円、%】



- 製品企画力強化により、技術設計改革の深化、戦略購買と計画的生産拡充による生産性の向上を進め、利益率改善を推進
- 半導体・パワーデバイス・バッテリー等で計画的生産体制を拡充
- 売上増加の効果等含め、利益率改善を目指す

売上総利益率推移 【単位：%】



①売上増⇒利益率アップ
②利益率高い半導体電子・コンポーネント比率アップ

【利益体質確立】
①見える化→赤字製品削減
②事後的費用発生抑制

①モノづくり力強化・生産性向上
計画的生産拡充
②売上増
③半導体電子比率アップ

①モノづくり力強化・生産性向上
②売上増
③半導体電子比率アップ

製品企画力強化

開発・営業・技術・設計・購買・製造・サービスの連携強化
QCDを意識した製品企画徹底

戦略購買力強化

計画的生産に対応した戦略購買体制構築
キーサプライヤーとの連携強化

モノづくり力強化

生産性向上

最適拠点生産
柔軟な経営資源配分体制構築

計画的生産拡充

モジュール化・標準化
リードタイム短縮

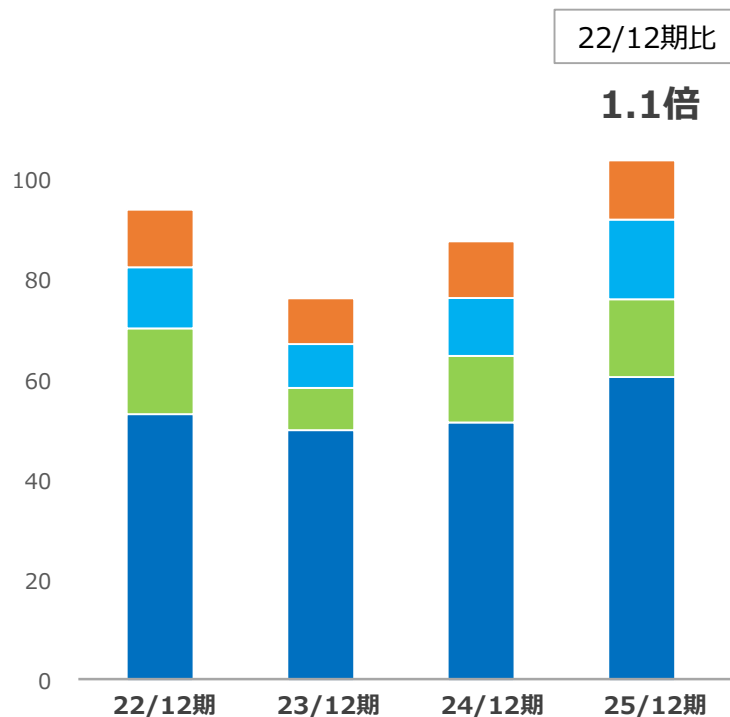
情報システム基盤強化

- 半導体設備投資は短期的に調整局面も、中長期的には投資拡大
- ロジック：MHM工程・新規顧客・新工程参入、メモリ：市場回復、新工程参入で成長

半導体設備投資予測

【単位：bnUS\$】

■ ロジック ■ NAND ■ DRAM ■ 他

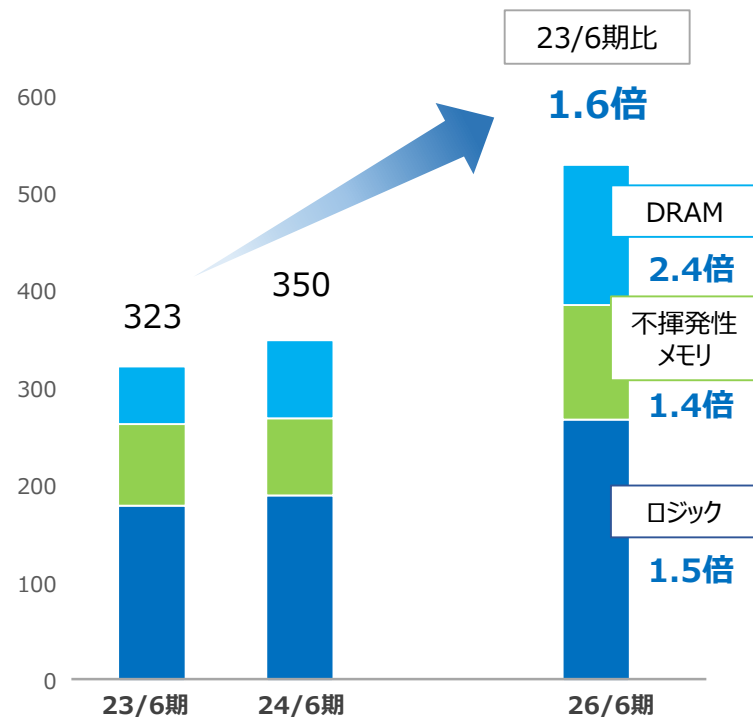


出所：SEMI等をもとに当社予測

受注見込み

【単位：億円】

■ ロジック ■ 不揮発性メモリ ■ DRAM



メモリ

- > 足元投資軟調も24年から投資回復見込
- > 市場回復に加えて、新工程参入で成長

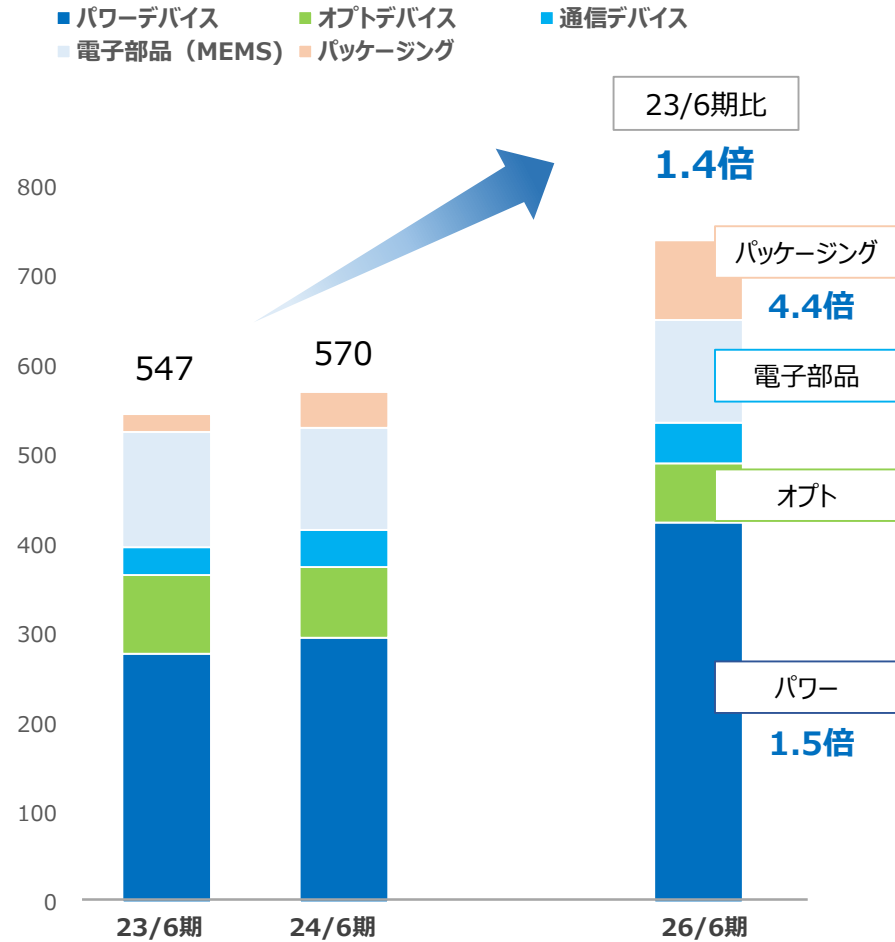
ロジック

- > MHM工程等の先端ロジック投資は着実に成長
- > 新規顧客：レガシー分野の生産増強投資継続
先端ロジック分野の新規顧客ビジネス開始
- > 新工程：MHM工程高評価・セカンドベンダー期待
- > 米国等、地域サプライチェーン構築のための投資拡大

- パワーデバイス、パッケージング等各種電子デバイスは技術革新投資・増産投資で日本・中国中心に成長継続

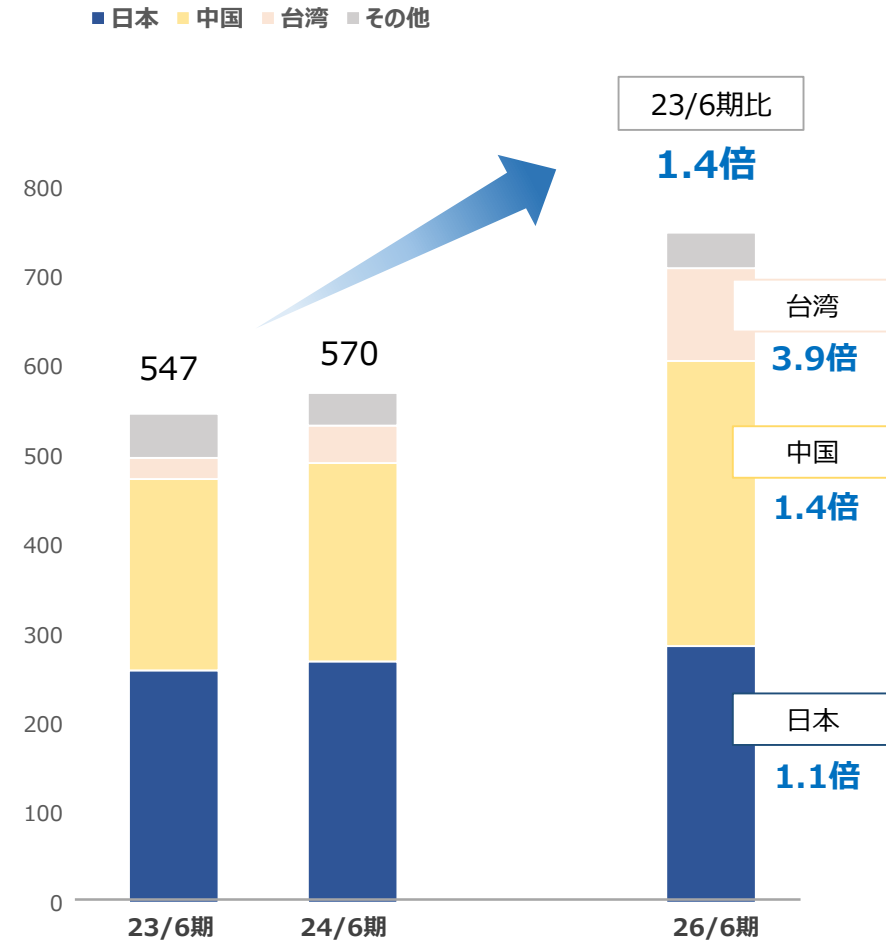
受注見込み（分野別）

【単位：億円】

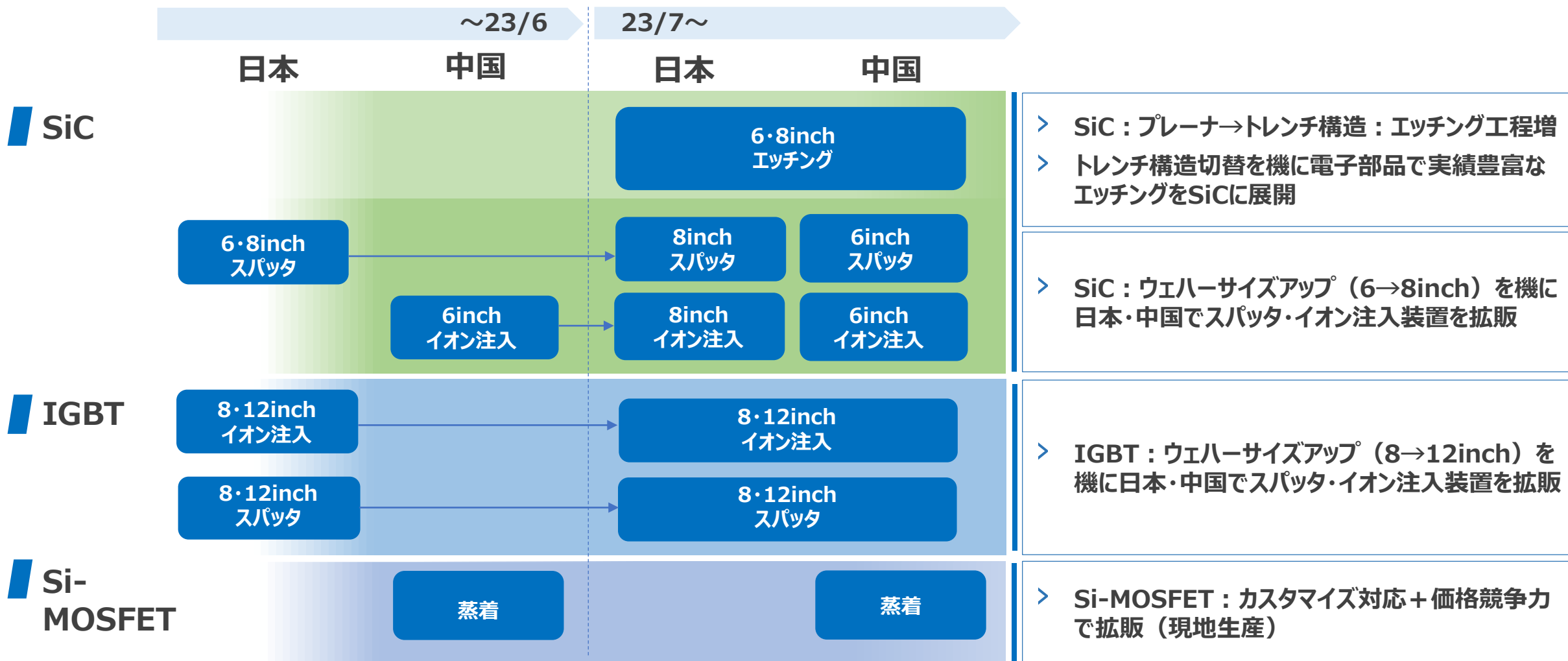


受注見込み（地域別）

【単位：億円】



- パワーデバイスはSiC中心に投資拡大継続
- ウェハーサイズアップ・構造変化に対応したビジネス拡大



- さまざまな分野での実績と幅広い装置ラインアップ→技術革新投資・増産投資・新プロセス参入で成長

■ オプトデバイス



~23/6

23/7~

μLED
エッチング

μOLED
蒸着・スパッタ

- > μOLED：AR/VR向け投資継続
- > μLED：省エネ・高輝度・高精細化＝次世代投資始動（既に大手にエッチング装置納入実績あり）
- > ウェハーサイズアップ投資も期待（6→8inch）

■ 電子部品（MEMS）



PZT
エッチング

PZT
スパッタ

- > PZT：独自材料スパッタに強み⇒エッチングもセット拡販

■ パッケージング



PLP
アッシング

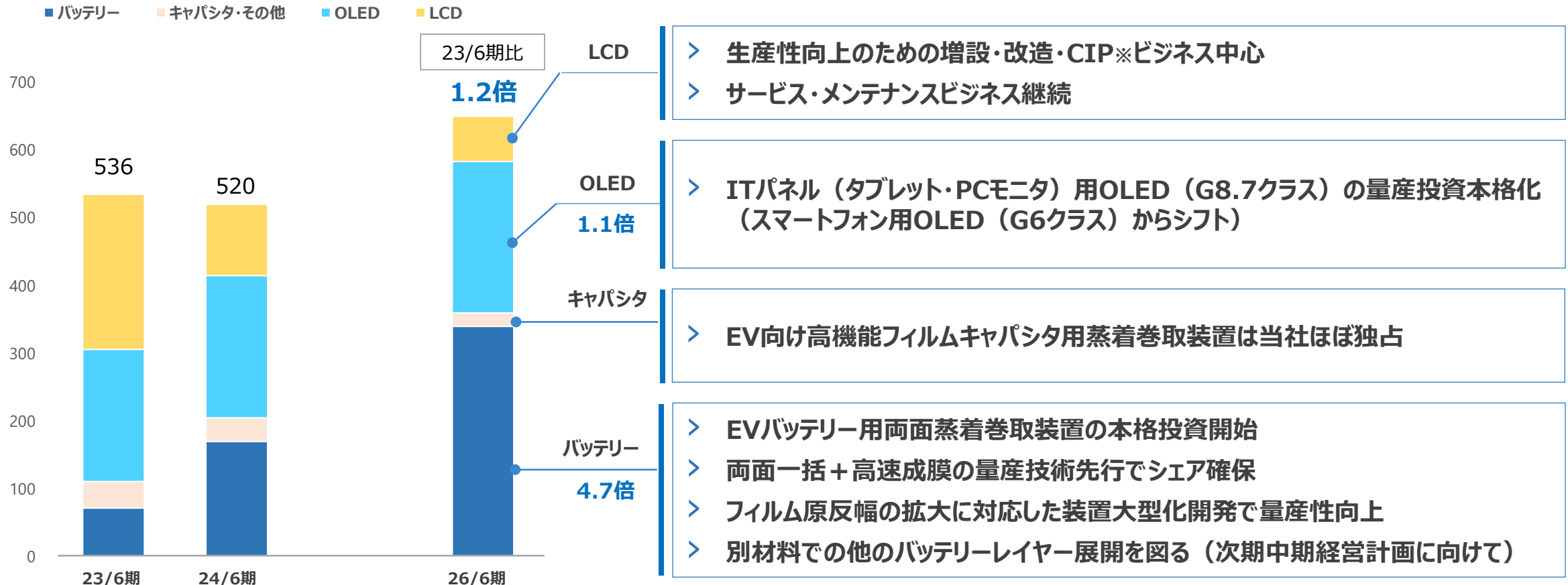
WLP・PLP
スパッタ

WLP
アッシング

- > 微細化に限界がある中、パッケージングに期待
- > 消費電力低減＝配線の改善が課題
- > WLPに加えPLP投資も活発化
- > アッシングに強みがあり、スパッタもセット拡販（主要顧客納入実績あり）

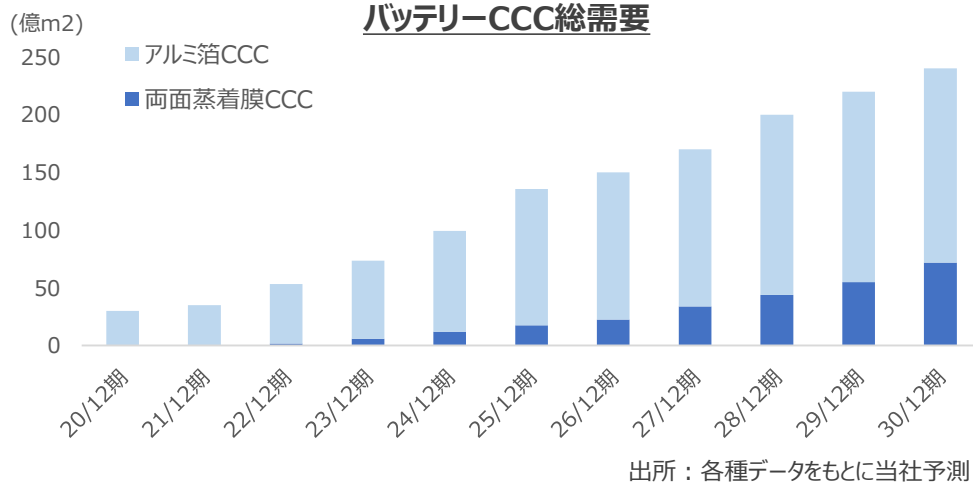
- EVバッテリー用両面蒸着巻取装置の本格投資開始 ⇒26/6期 : 300億円以上の受注を見込む
- ITパネル用大型基板OLEDのスパッタ装置の投資も開始

受注見込み 【単位：億円】

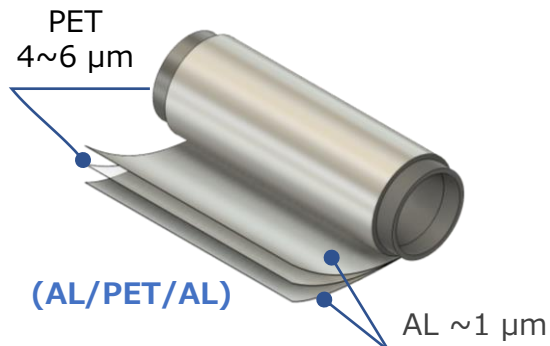


※CIP : 改善改良提案

- EVバッテリーの小型大容量化・安全性向上実現のため、従来の金属箔から両面蒸着膜への置き換え投資本格化
- 両面蒸着巻取装置でシェア確保：量産性向上モデル開発・他材料展開で更に差別化

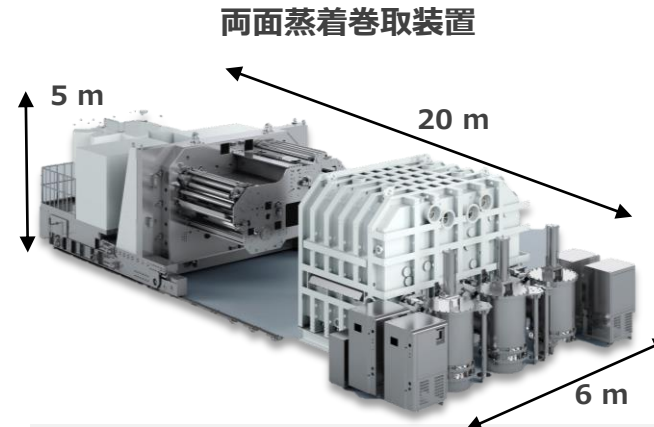


正極集電体 (CCC)
アルミ箔 → 両面蒸着膜 (アルミ/PET/アルミ)
 ⇒小型大容量化・軽量化・安全性向上実現



アルバックの強み

- 1 熱ダメージ抑制による高速長尺成膜
- 2 フィルム広幅化による量産性向上



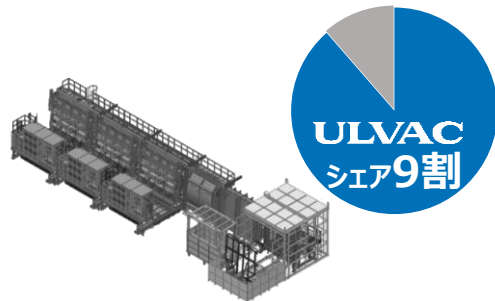
- 車載用フィルムキャパシタ向け蒸着巻取装置：薄フィルムへの高速片面成膜でシェア9割以上
- EVバッテリー用蒸着巻取装置：両面一括・1回成膜（競合他社：複数回成膜要）
- フィルムへの除熱技術等により高品質両面蒸着膜を実現
- 今後、①フィルム広幅化モデル開発 = 量産性向上（25/6期~）、②別材料で他のバッテリーレイヤー展開 等で先行しシェア確保

- 低パーティクル成膜技術を活かし、ITパネル用OLED（G8.7クラス）スパッタ装置のシェア確保
- データ解析サービスで顧客の工数削減・歩留まり改善→カスタマーサポートビジネス拡大

アルバックの強み

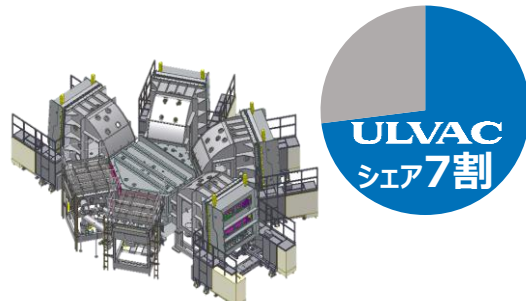
1 高精細かつ大型基板に対応した低パーティクル成膜

LCD・縦型スパッタリング装置（G10.5）



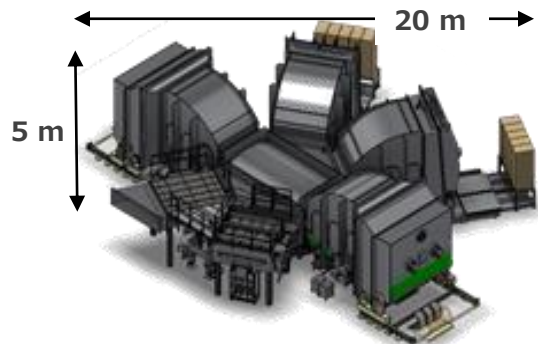
主な強み：カソードの大型化
大型パネル搬送ノウハウ

OLED・枚葉型スパッタリング装置（G6）



主な強み：低パーティクル

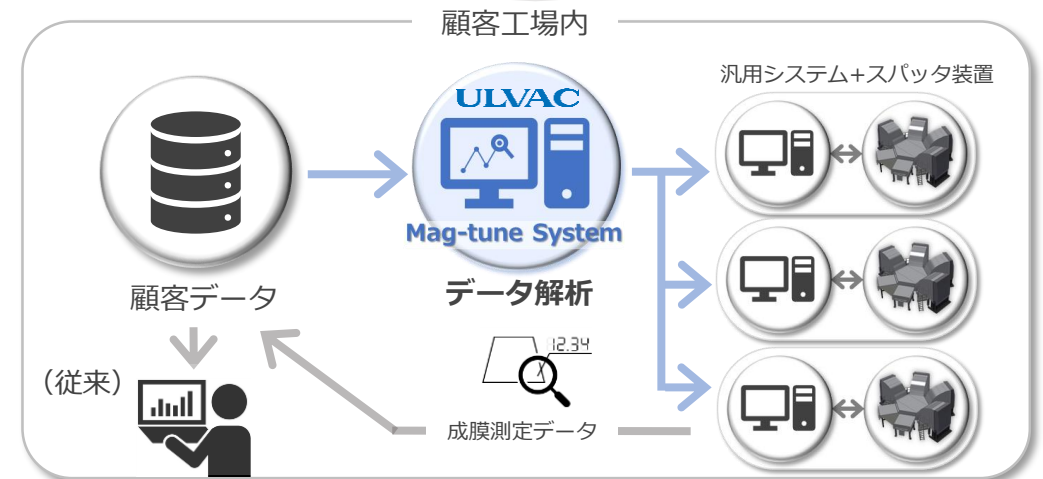
枚葉型スパッタリング装置（G8.7）



- > OLED高精細化
→低パーティクル化必要
- > 大型化技術と低パーティクル技術で
ITパネル用OLED（G8.7）スパッタ
装置シェアNo.1を確保

アルバックの強み

2 スパッタ装置の導入実績最多

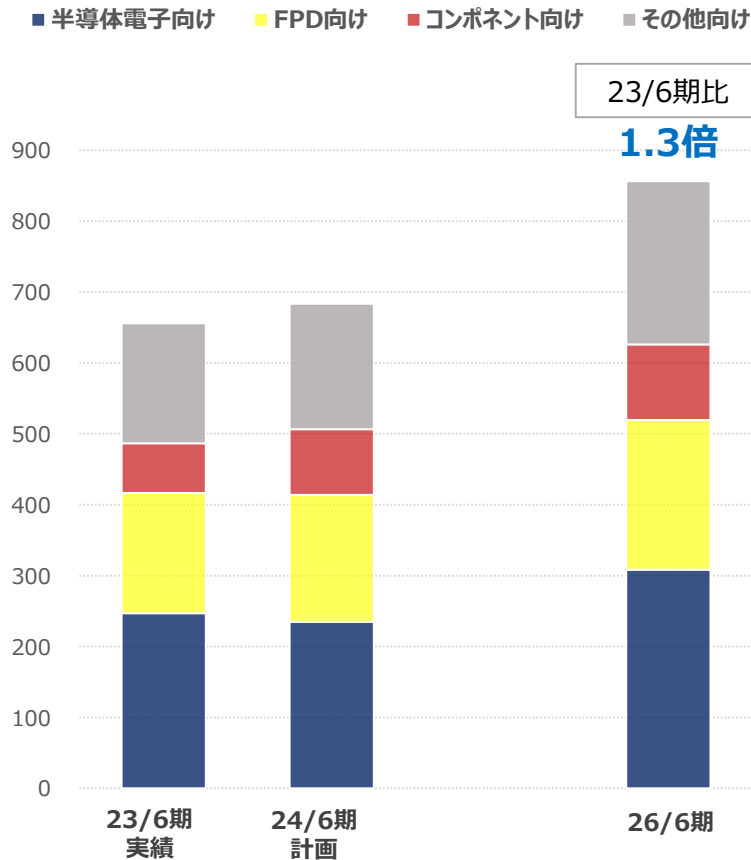


- > スパッタ稼働（基板成膜）時に膜質が変化した場合、
従来：属人的に膜質調整
新提案：当社ノウハウで自動データ解析（Mag-tune）
→自動プロセスチューニングで膜均一性維持（採用実績有）
⇒工数削減・歩留まり改善に向けたCIP※ビジネス拡大

※CIP：改善改良提案

- カスタマーサポート事業は、既存ビジネス拡大、戦略地域サポート強化、開発提案型CIP強化等で成長

CS受注内訳（参考）【単位：億円】



アルバックの強み

1 装置・施工ノウハウ

2 装置納入実績が多い

> 既存ビジネス拡大

半導体電子・FPD装置納入実績：約7,000台強

→納入済装置のサポート継続+納入台数増加でビジネス拡大

> 戦略地域サポート強化

装置納品台数増加が著しい中国市場のサポート強化

米国ビジネス拡大によるサポート強化

> 開発提案型CIP※強化

施工ノウハウの強みを活かし、装置の付帯設備設置など総合的なエンジニアリングサービス拡大



※CIP：改善改良提案

- 安定ビジネス基盤であるコンポーネント・マテリアルビジネスも成長

コンポーネント

アルバックの強み

- 1 装置ノウハウ→ポンプ・計測機器・電源の仕様改善
- 2 東アジアのサービスネットワーク

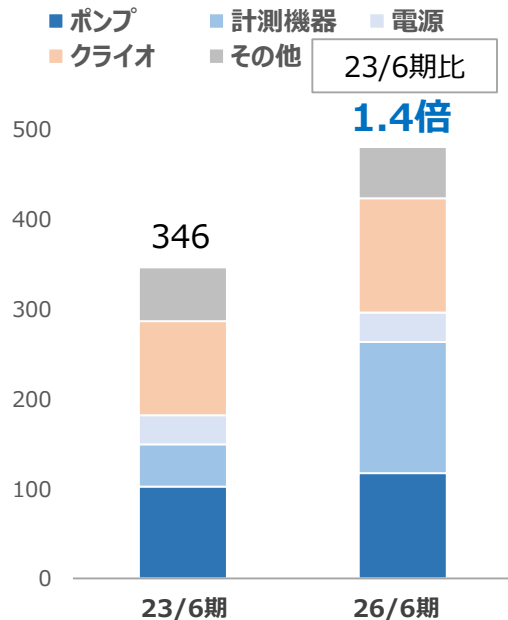
マテリアル

アルバックの強み

- 1 先端半導体向け高品質焼結ターゲット（W・WSi）
- 2 FPD向けメタル・IGZOターゲット：高シェア

受注見込み

【単位：億円】



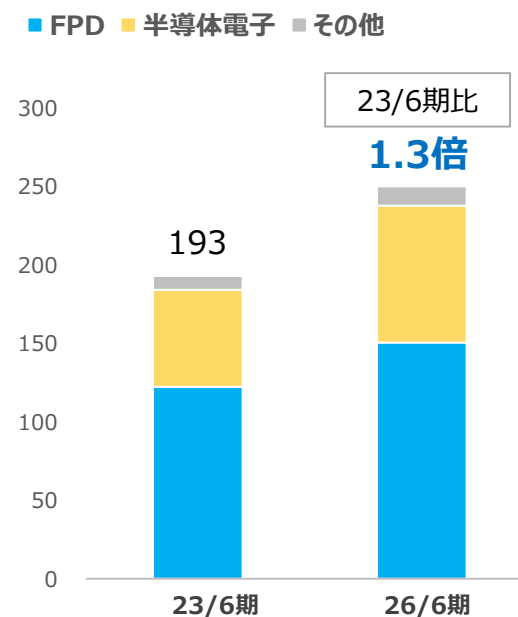
成長ドライバー

- > EV/Liバッテリー用中小型ポンプ・リークディテクター
- > FPD・半導体向けクライオポンプ

※リークテスト装置：24/6期より一般産業→コンポーネントに変更
 （23/6期にリークテスト装置を加えると1.2倍）

受注見込み

【単位：億円】

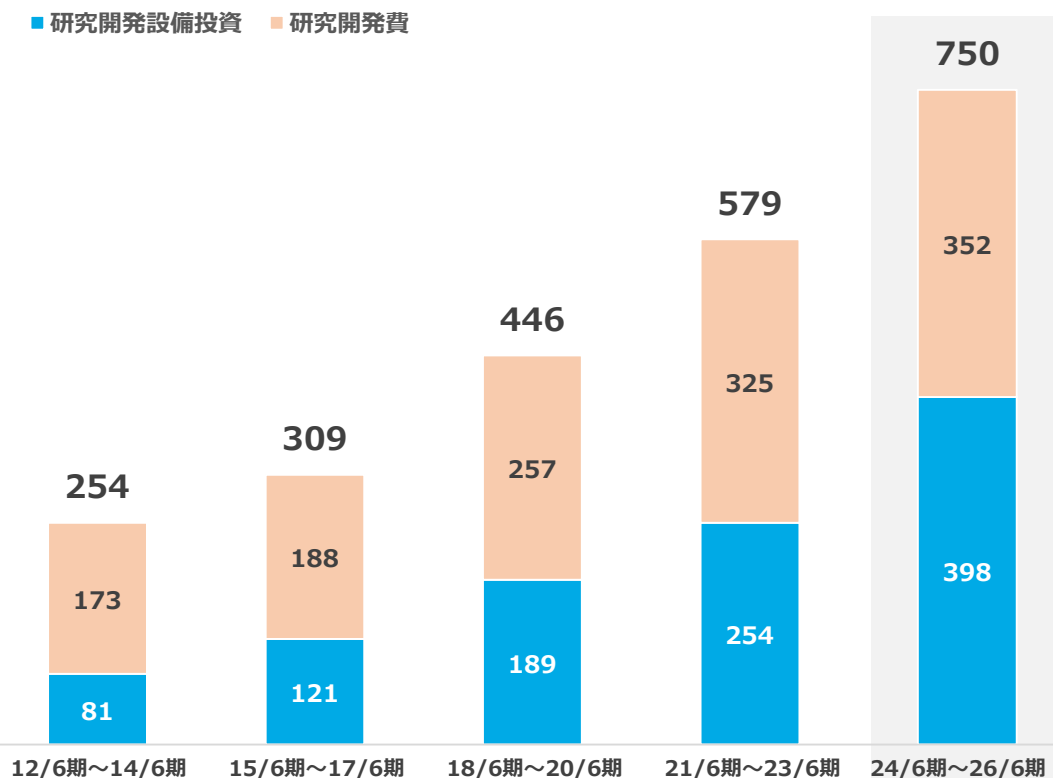


成長ドライバー

- > 先端半導体の市場成長とシェアゲイン
- > パワーデバイス市場成長
- > FPD顧客稼働率の回復

- 成長ドライバー(半導体、パワーデバイス、バッテリー等)の研究開発強化
 - 韓国テクノロジーセンター建設：顧客の近くで製品・技術開発加速、コラボレーションと技術サポート強化
- ⇒ さらなる成長に向けた研究開発投資継続

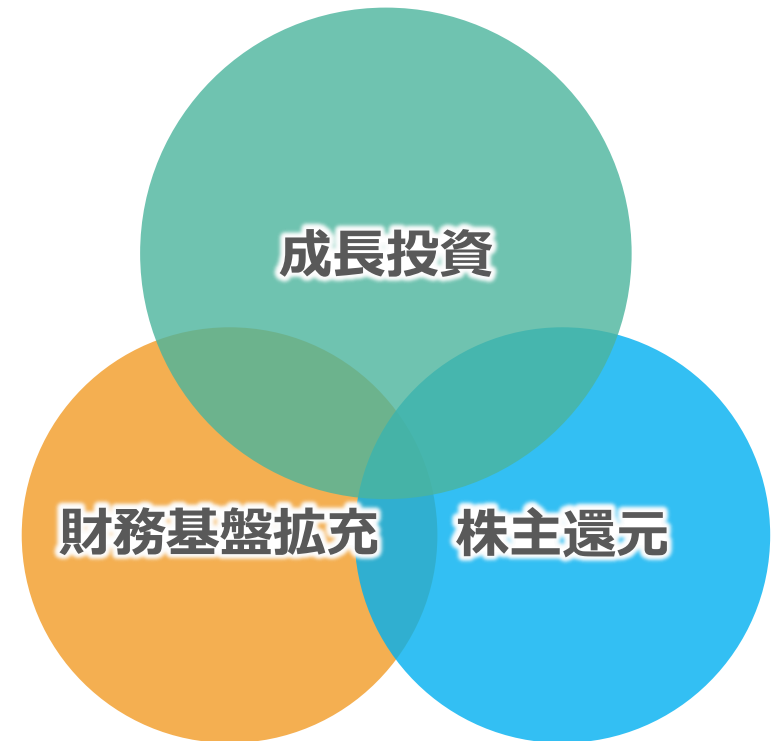
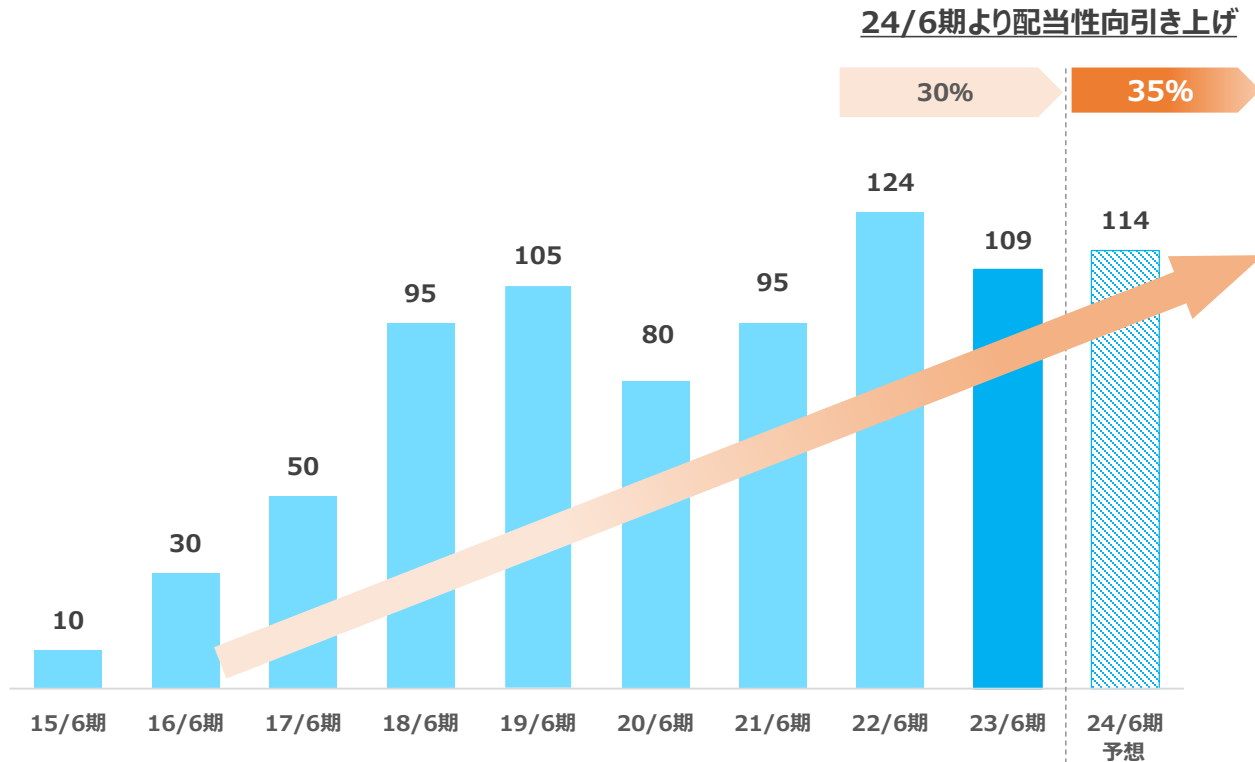
研究開発投資推移（3年合計）【単位：億円】

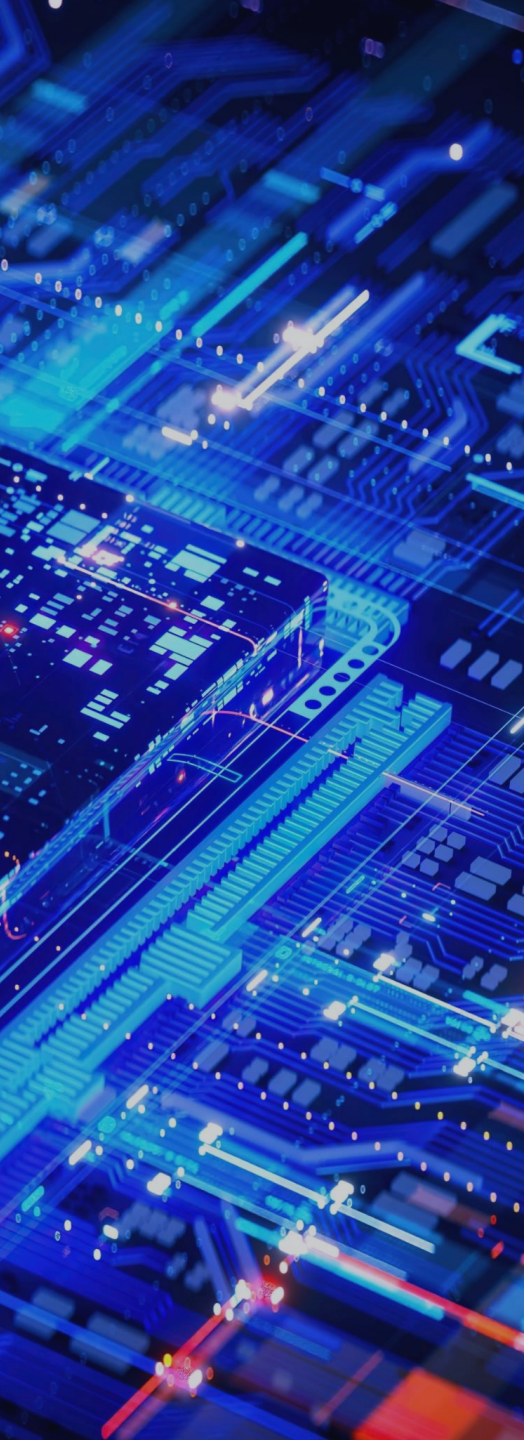


- > 半導体：4割強
ロジック・メモリ (MHM・配線工程向けスパッタ)
- > 電子：2割強
パワーデバイス (イオン注入・スパッタ・エッチング等)
- > FPD：1割半ば
バッテリー (蒸着)
- > その他：2割強

- 半導体、電子を中心に成長分野への開発投資を加速
- 株主還元を最重要政策の一つと位置づけ、更なる成長により長期的な配当増額を目指す
- 財務基盤の状況等勘案し、24/6期より業績連動配当性向を35%へ引き上げ
- 業界変動や技術革新の激しい業界にあり、これらのリスクや資金需要に対応するため財務基盤も拡充

1株当たり配当金推移 【単位：円】





2024年6月期 連結業績予想

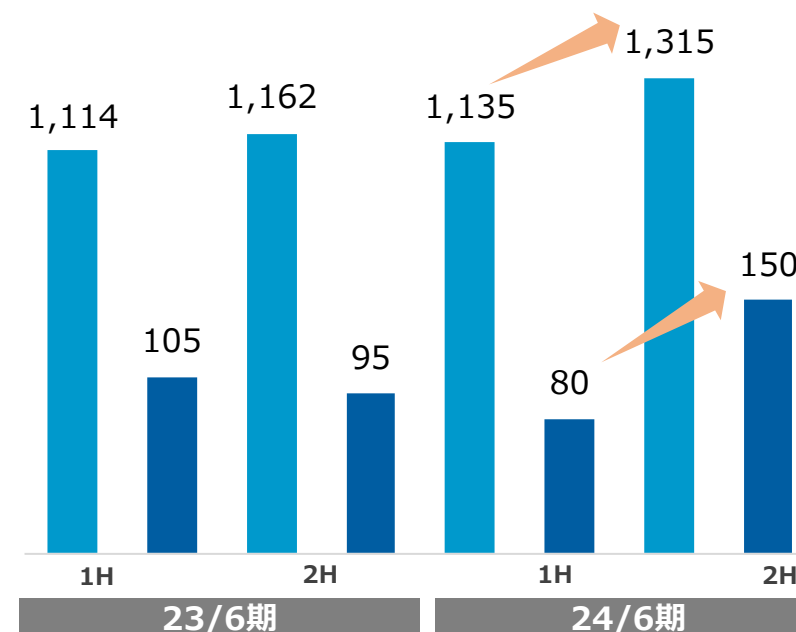
- 受注高：半導体電子の成長継続で2,500億円に増加計画
- 売上高：半導体電子の計画的生産拡充等により2,450億円に売上増加計画
- 営業利益率：9.4%（前年同期比+0.6pt）に改善計画
- 24/6下期より売上高・営業利益ともに回復

【単位：億円】	23/6期	24/6期 計画					
	実績	上期	下期	通期	前年同期比		
受注高	2,472	1,310	1,190	2,500	+28	+1%	
売上高	2,275	1,135	1,315	2,450	+175	+8%	
営業利益	199	80	150	230	+31	+15%	
率	8.8%	7.0%	11.4%	9.4%	+0.6pt	-	
経常利益	229	90	155	245	+16	+7%	
率	10.1%	7.9%	11.8%	10.0%	-0.1pt	-	
親会社株主に帰属する 当期純利益	142	55	105	160	+18	+13%	
率	6.2%	4.9%	8.0%	6.5%	+0.3pt	-	

売上高と営業利益の推移

【単位：億円】

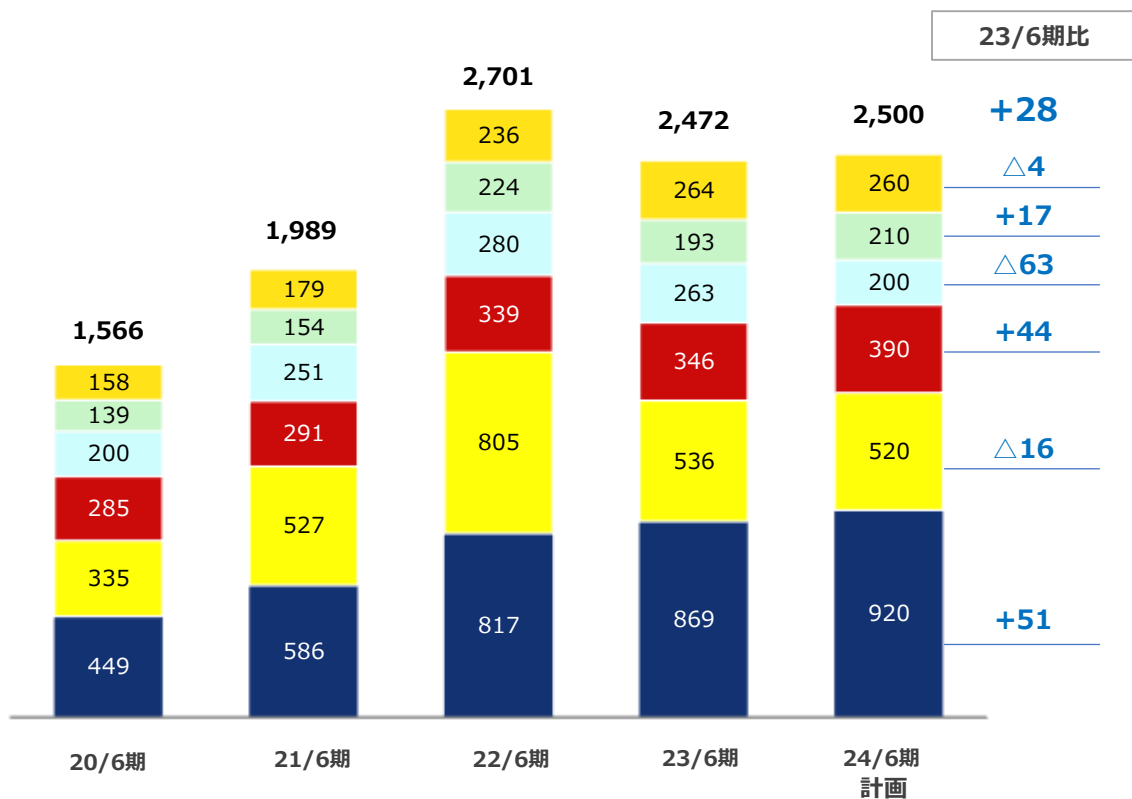
■ 売上高 ■ 営業利益



- 受注高：半導体電子の成長継続で2,500億円に増加計画
- 売上高：半導体電子の計画的生産拡充等により2,450億円に売上増加計画

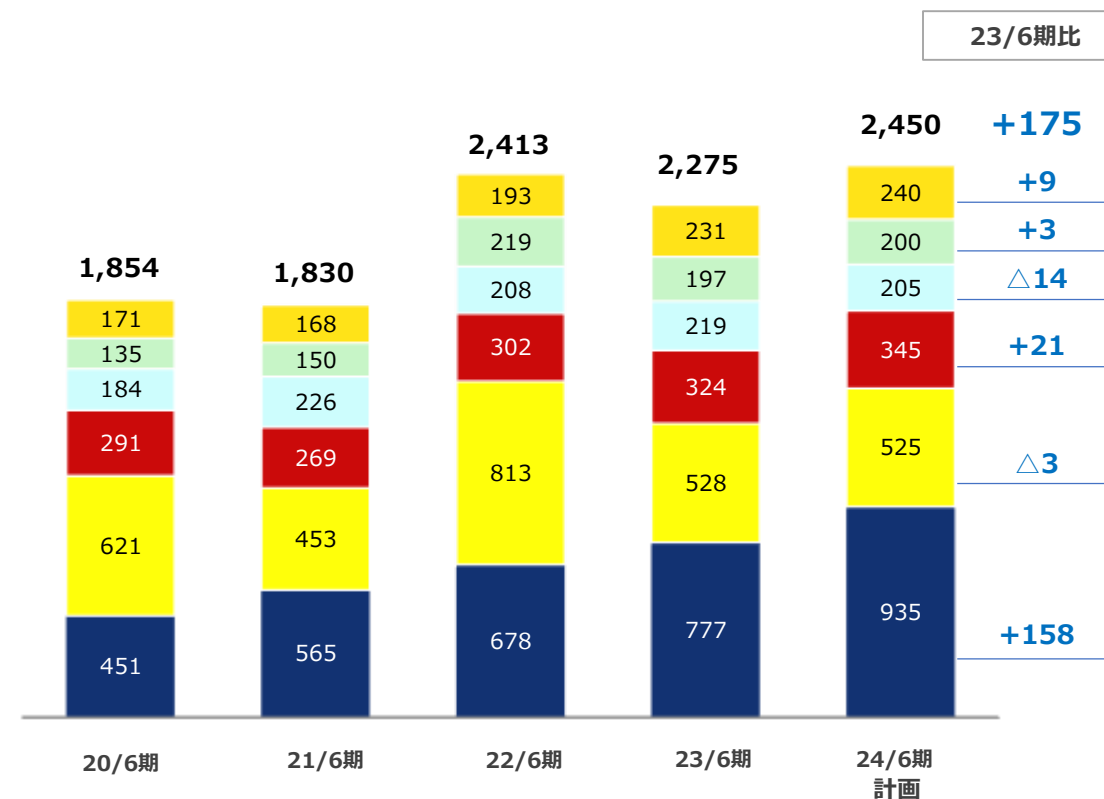
受注高

【単位：億円】



売上高

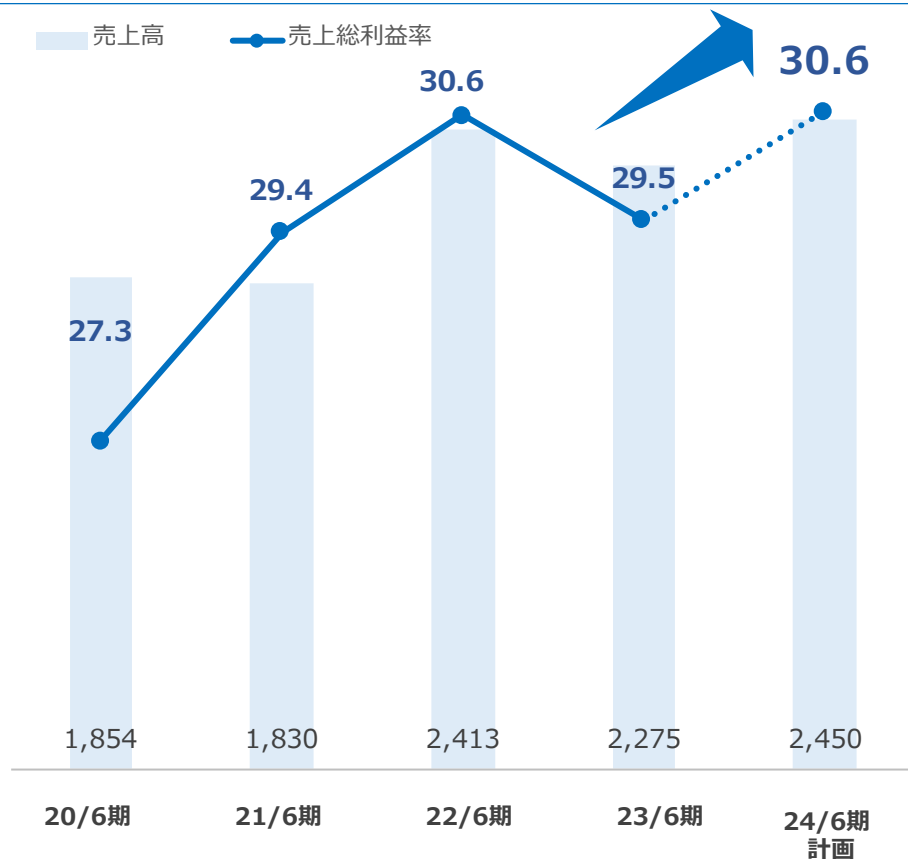
【単位：億円】



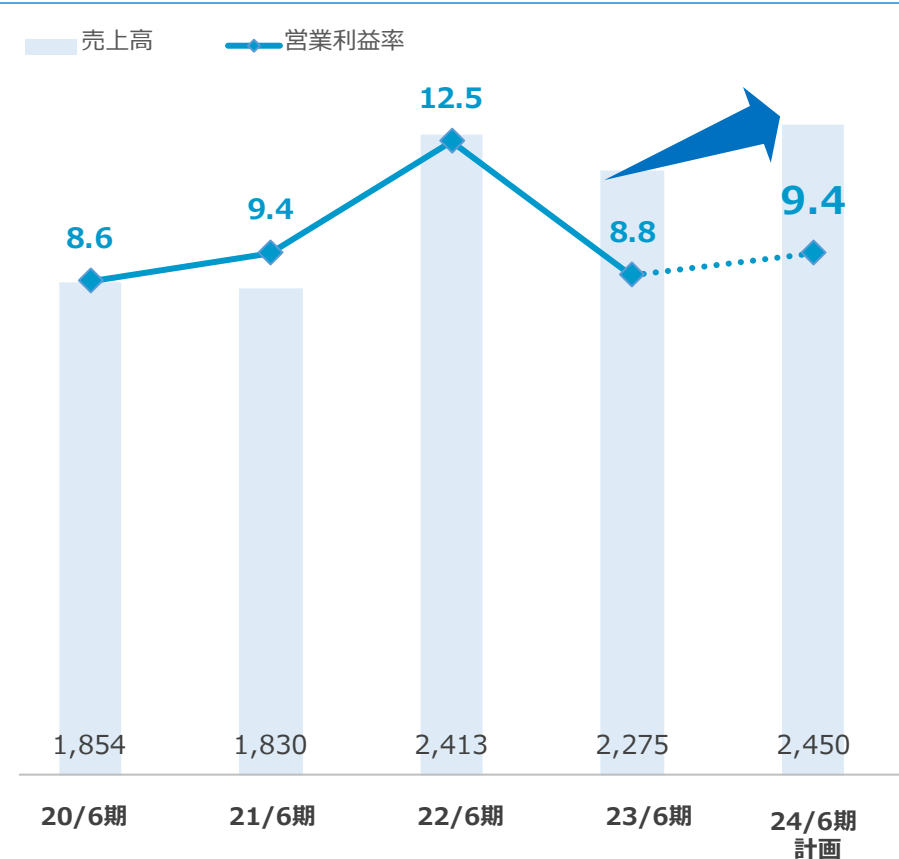
3 モノづくり力強化等により利益率改善を推進

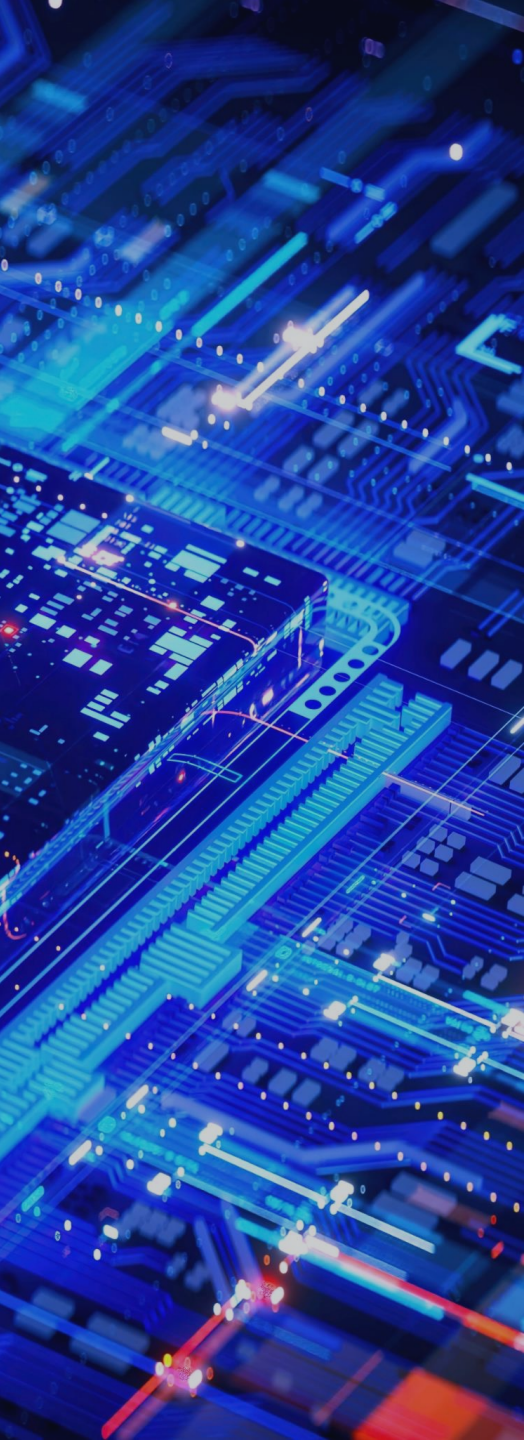
- 受注済案件には部材長納期化の影響が残るため改善効果は段階的となるが、モノづくり力強化・生産性向上、売上増加等により、売上総利益率・営業利益率を高める計画

売上総利益率 【単位：億円、%】



営業利益率 【単位：億円、%】

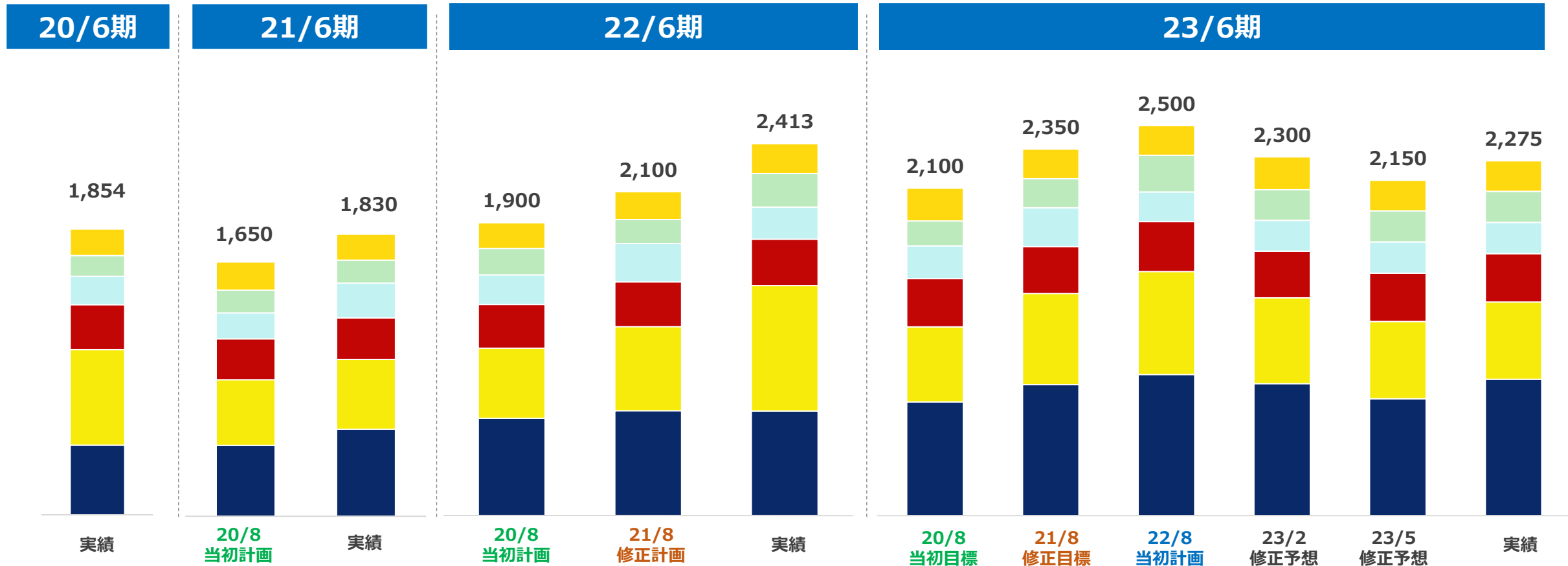




補足資料

売上高

【単位：億円】

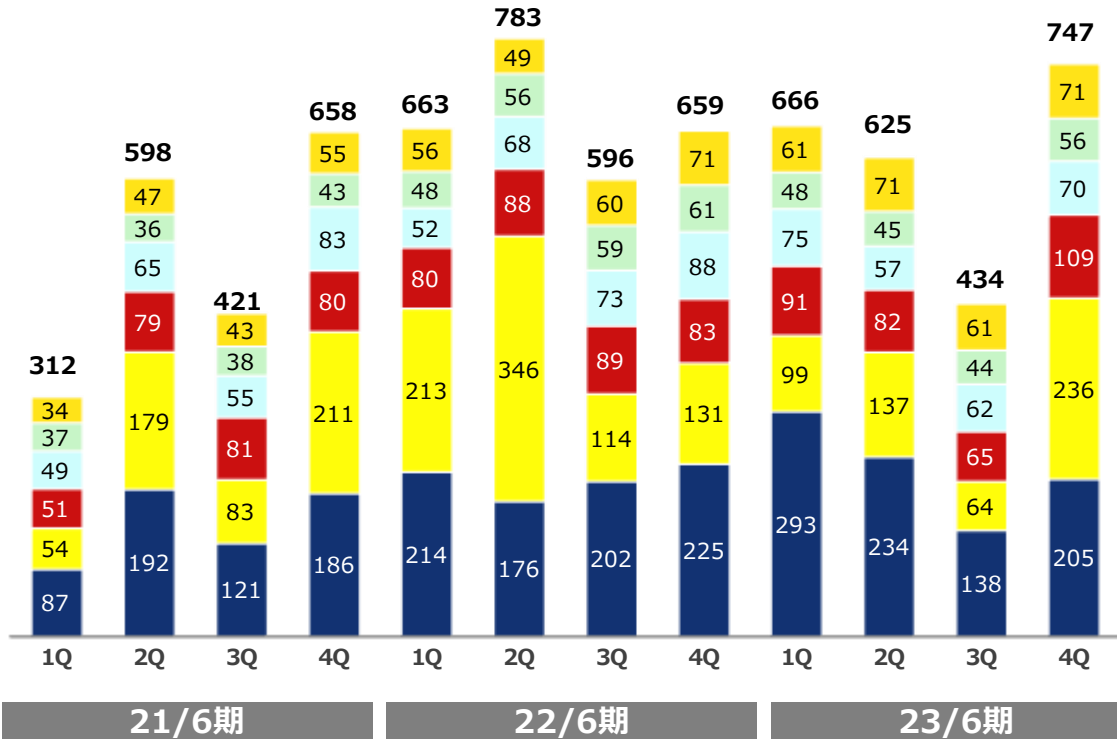


【単位：億円】	22/6期				23/6期				前年同期比	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	増減額	増減率
	受注高	663	783	596	659	666	625	434	747	+88
売上高	474	583	604	752	562	552	496	666	-86	-11%
売上総利益	132	189	186	230	165	168	147	191	-39	-17%
率	27.9%	32.4%	30.8%	30.6%	29.3%	30.5%	29.7%	28.7%	-1.9pt	-
販管費	97	110	105	125	113	115	125	119	-5	-4%
営業利益	36	78	81	105	51	53	23	72	-33	-32%
率	7.5%	13.5%	13.5%	14.0%	9.1%	9.7%	4.6%	10.8%	-3.2pt	-
経常利益	35	85	84	118	52	65	39	72	-45	-39%
率	7.4%	14.6%	13.9%	15.6%	9.3%	11.8%	7.8%	10.8%	-4.8pt	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	22	59	56	64	41	53	24	24	-40	-62%
率	4.7%	10.1%	9.3%	8.6%	7.2%	9.6%	4.9%	3.6%	-4.9pt	-

3 品目別受注高・売上高推移（四半期実績）

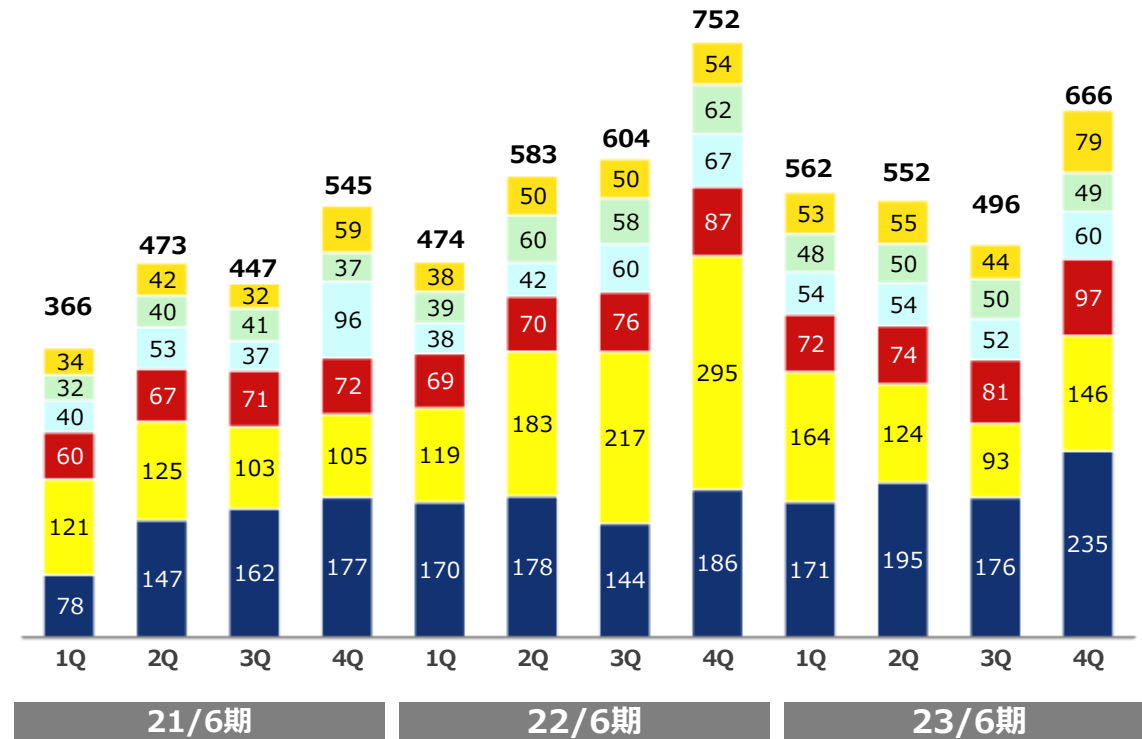
受注高 【単位：億円】

- 半導体及び電子部品製造装置
- コンポーネント
- 材料
- FPD製造装置
- 一般産業用装置
- その他



売上高 【単位：億円】

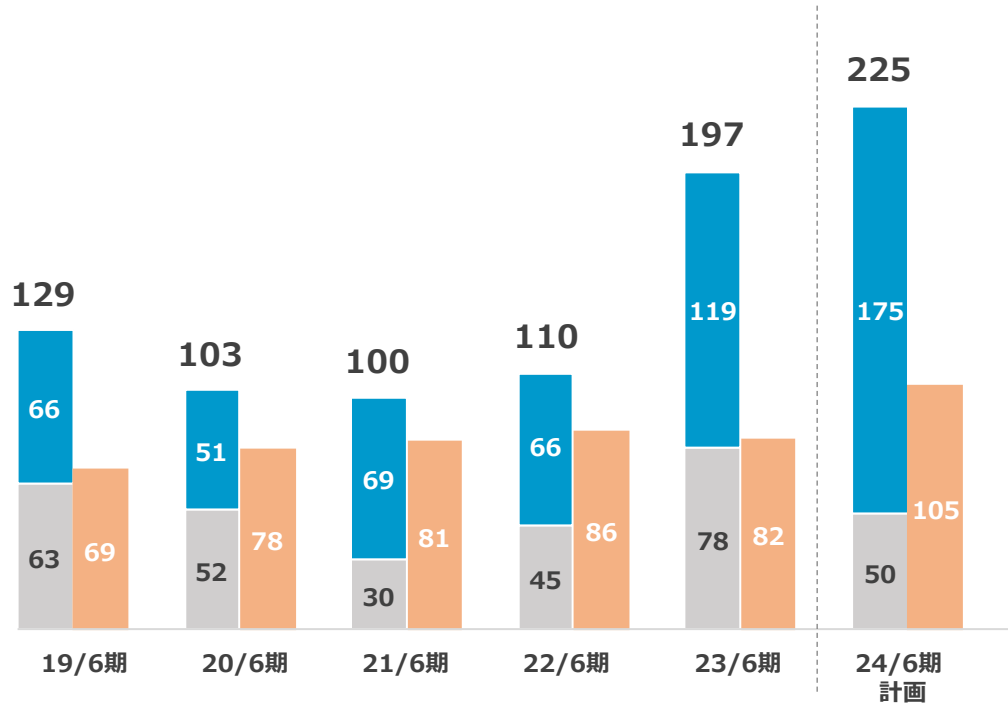
- 半導体及び電子部品製造装置
- コンポーネント
- 材料
- FPD製造装置
- 一般産業用装置
- その他



設備投資の推移・計画

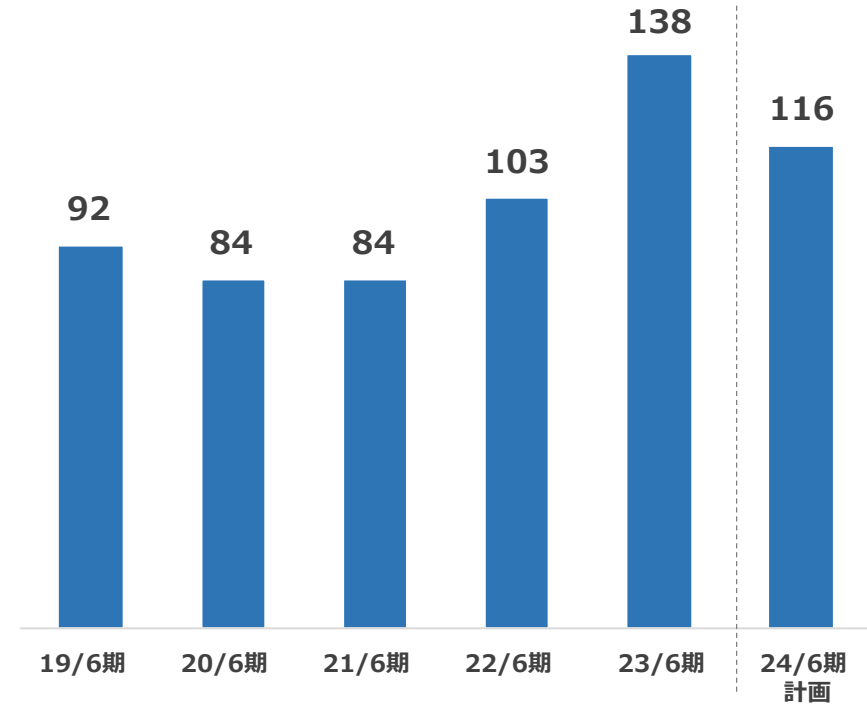
【単位：億円】

- 建物・生産設備等
- 研究開発設備
- 減価償却費



研究開発費の推移・計画

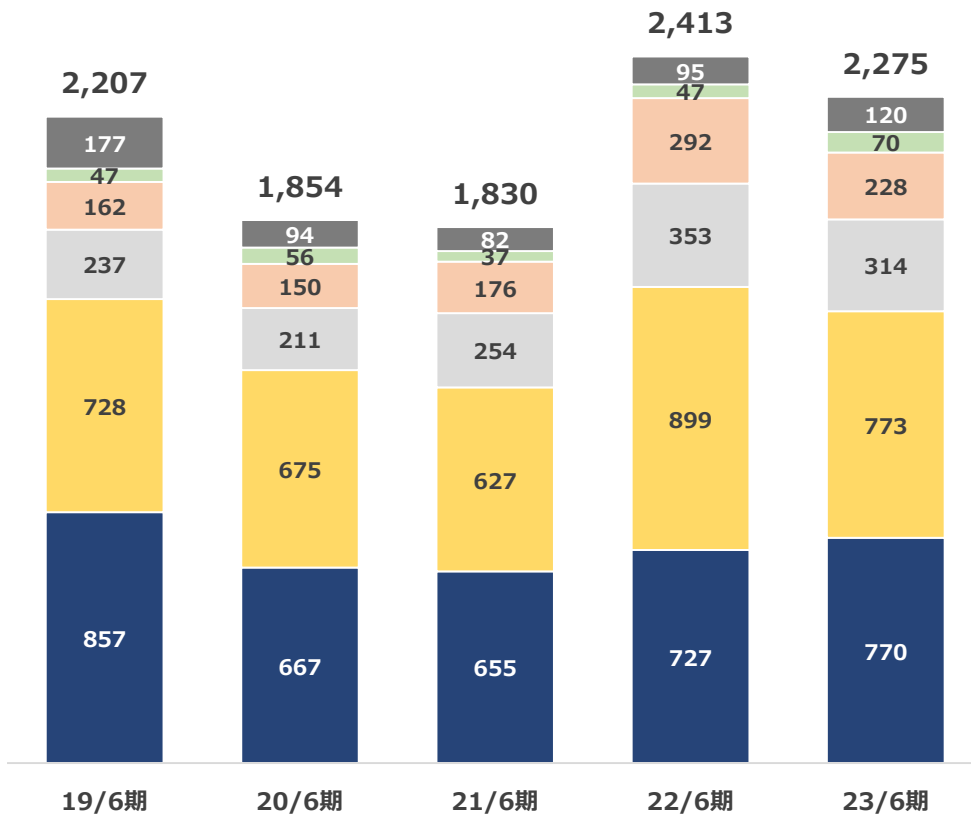
【単位：億円】



売上高

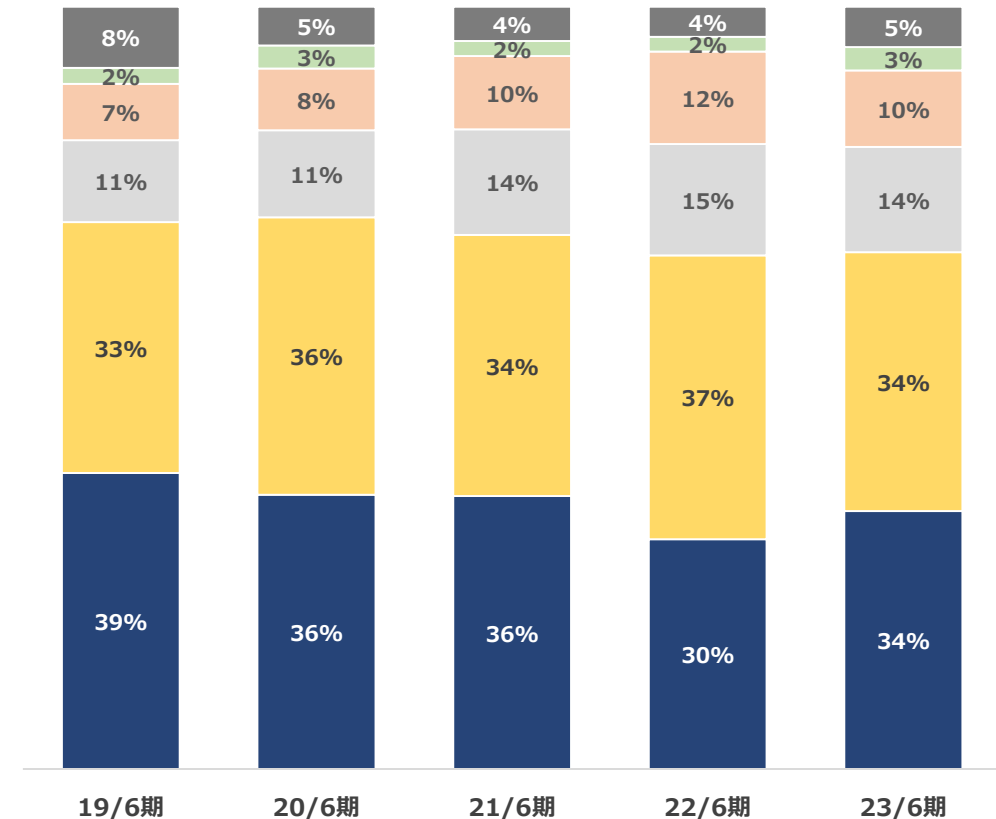
【単位：億円】

■ 日本 ■ 中国 ■ 韓国 ■ 台湾 ■ その他アジア ■ 欧米他



売上高比率

■ 日本 ■ 中国 ■ 韓国 ■ 台湾 ■ その他アジア ■ 欧米他



AI

人工知能(AI) 電子部品
半導体

- 半導体
- 電子部品
- コンポーネント
- 材料

病院

IoT 遠隔医療 ワクチン
無菌製剤

- 半導体
- 電子部品
- FPD
- 一般産業用
- コンポーネント
- 材料

データセンター

データセンター パワーデバイス
半導体メモリ 電子部品
ロジック半導体

- 半導体
- 電子部品
- コンポーネント
- 材料

電動車

電動車 高性能バッテリー
パワーデバイス 磁石
電子部品

- 半導体
- 電子部品
- FPD
- コンポーネント
- 材料

真空遮断器

真空遮断器 熱交換機

- 一般産業用
- コンポーネント

風力発電

風力発電
パワーデバイス
発電用高性能磁石

- 半導体
- 電子部品
- 一般産業用
- コンポーネント
- 材料

スマートホーム

スマートホーム
スマートホーム
半導体
電子部品
ディスプレイ

- 半導体
- 電子部品
- FPD
- コンポーネント
- 材料

フリーズドライサプリメント

フリーズドライ
サプリメント

- 一般産業用
- コンポーネント

ドローン

ドローン
スマート農業
半導体
電子部品
バッテリー

- 半導体
- 電子部品
- コンポーネント
- 材料

太陽電池

太陽電池発電設備
制御用パワーデバイス

- 電子部品
- FPD
- コンポーネント
- 材料



社会的課題解決

スマート社会・
デジタル社会実現グリーンエネルギー化
低消費電力化

メモリ

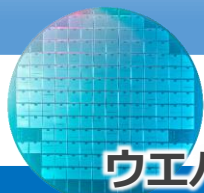
ロジック IC

センサー・電子部品

パワーデバイス

バッテリー

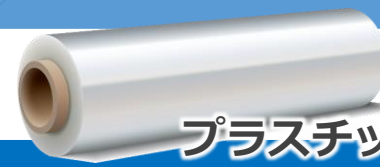
微細化 / 高性能化 / 低消費電力化



ウエハー



ガラス



プラスチック

真空薄膜形成技術

スパッタリング

蒸着

CVD

エッチング・アッシング

イオン注入

コンポーネント

マテリアル

カスタマーサポート

さまざまな業界・用途で貢献する アルバックの真空技術



ULVAC